

2023年3月期第2四半期 決算説明会

2022年11月16日

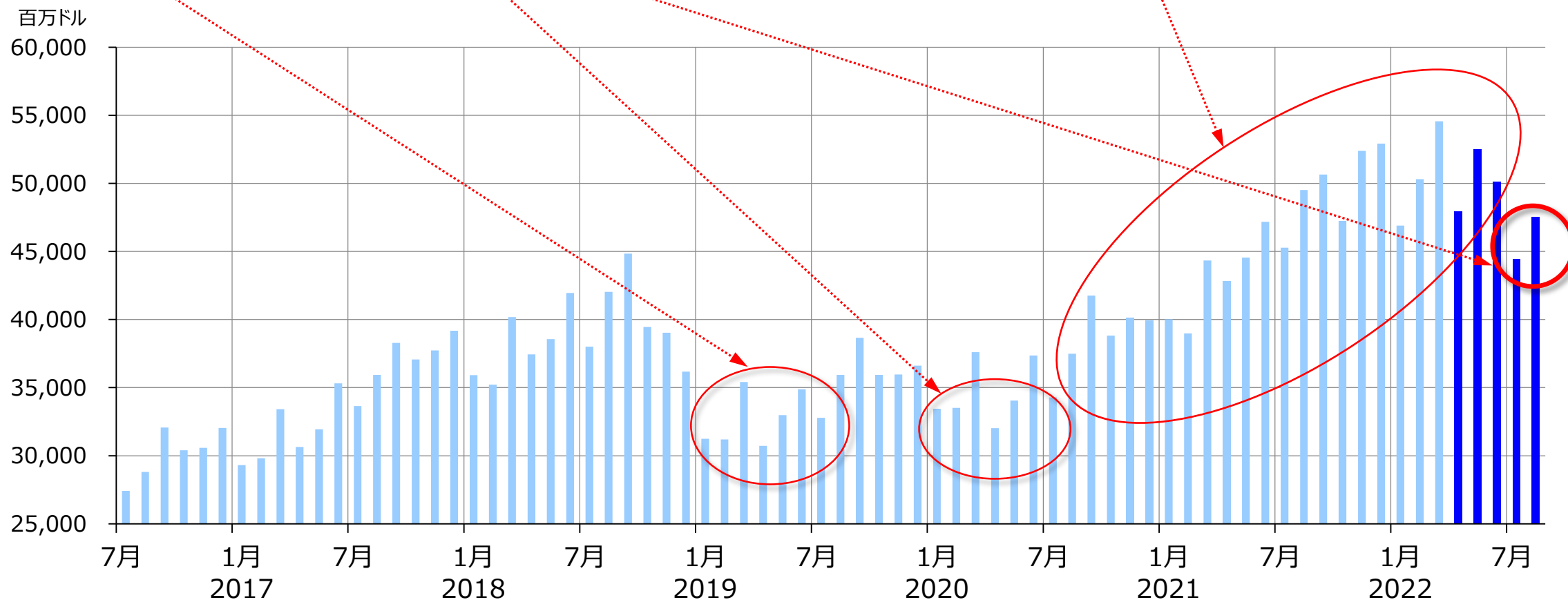
株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2022年8月まで）

出所：WSTS（2022/10）

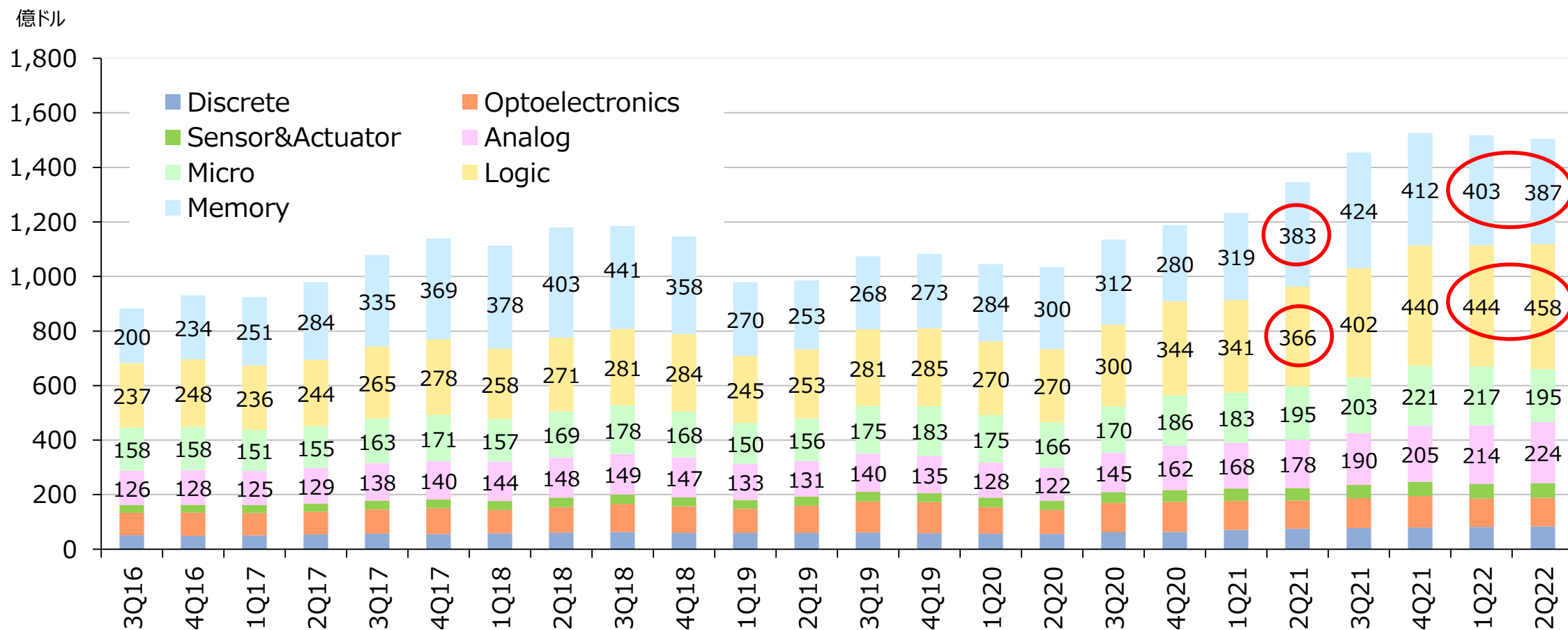
- ・ 2019年、メモリバブルの反動で1月から7月まで半年ほど低迷した後、北米、中国を中心に回復
- ・ 2020年、新型コロナの影響で1月より再び下降 同年8月以降上昇に転じ、強い半導体需要が2022年6月まで継続
- ・ 2022年、7月 8月は前年同期比で減少



世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

出所：WSTS

- 2022年4-6月期の世界半導体市場：ロジックは伸長(QoQ + 3 %, YoY +25%)、メモリは調整局面(QoQ - 4 %, YoY + 1 %)

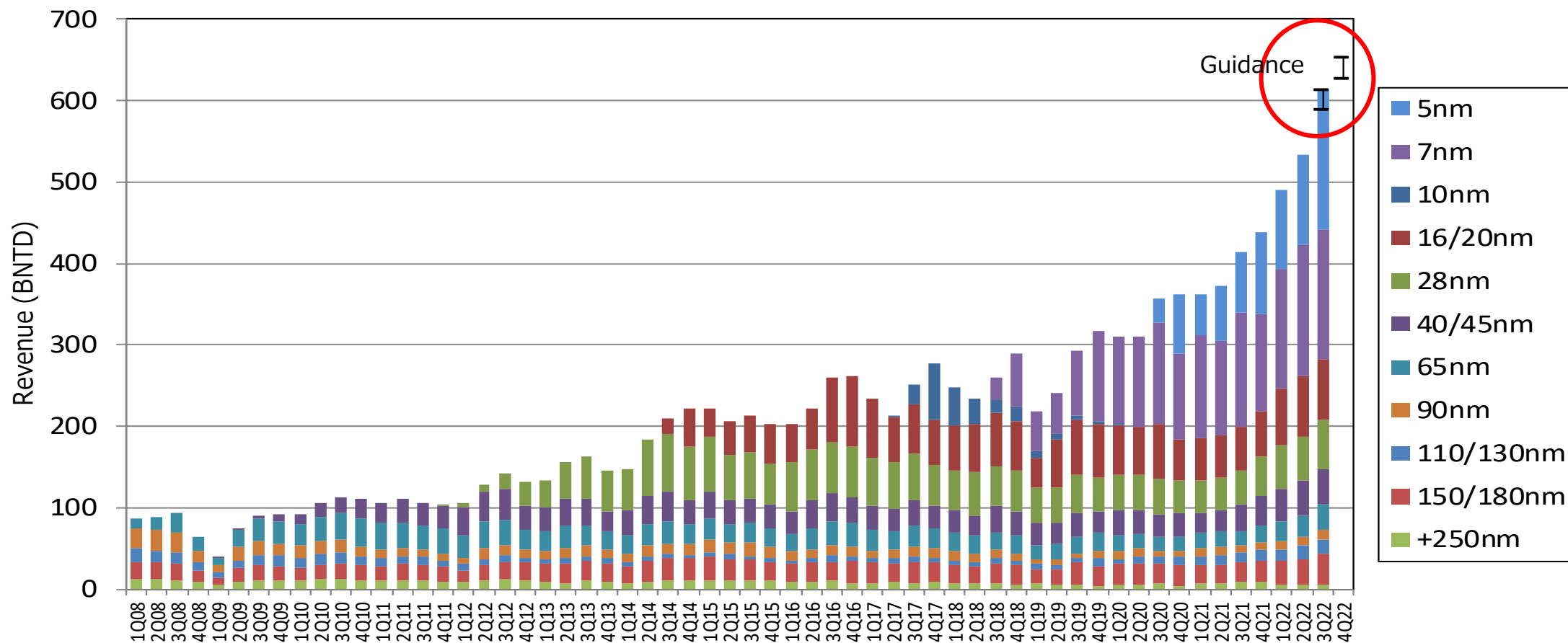


《暦年ベース》

台湾セミコンダクター（TSMC） 売上高（2022年7-9月期）

出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

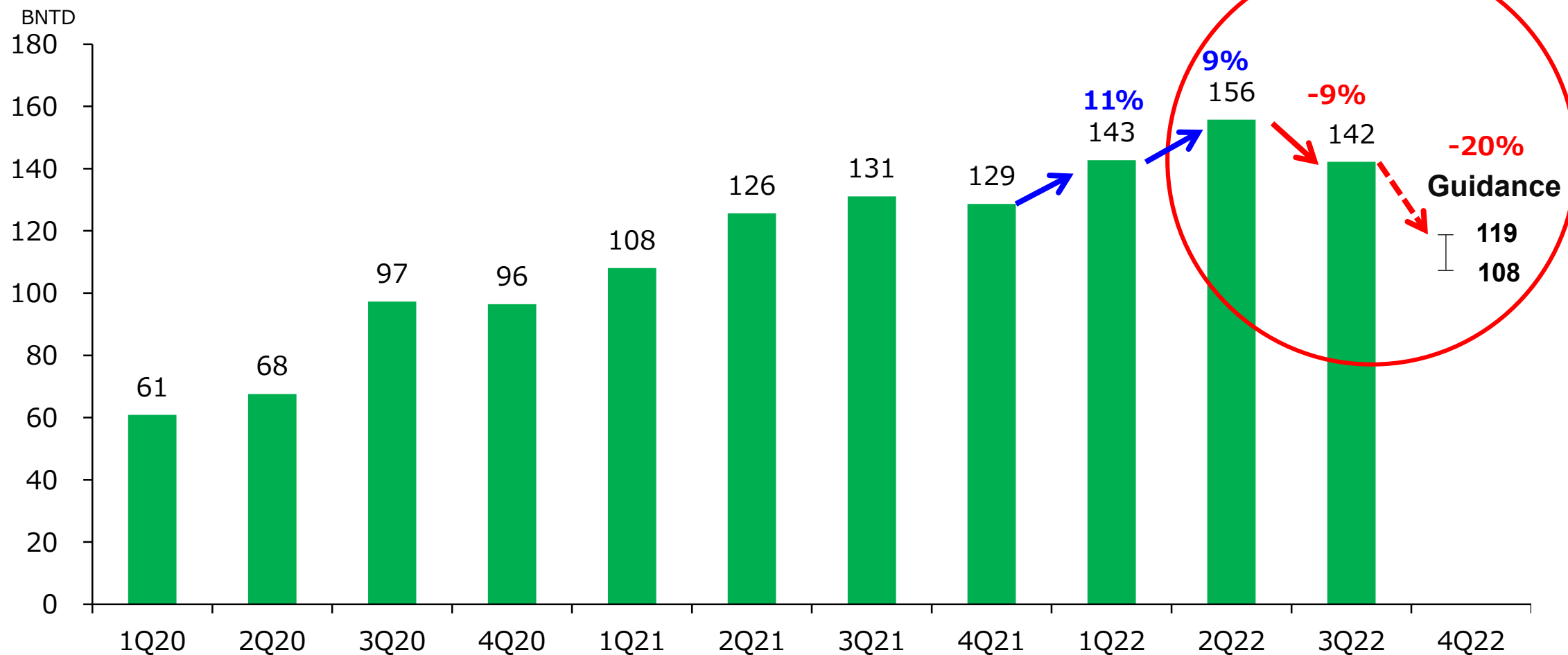
- 22年1Q（1-3月期）に続き、2Q（4-6月期） 3Q（7-9月期） いずれも売上高は過去最高を更新
- 22年4Q（10-12月期） も過去最高を更新見込（ガイダンスベース）
- 22年3Q（7-9月期） のNode別売上高は、7nmプロセスが微減（QoQ -2%）
- 2022年の設備投資を下方修正（400億米ドル→360億米ドル）



メディアテック 売上高 (2022年7-9月期)

出所：メディアテック公開情報よりフジミ作成

- ・スマホ向け製品の在庫調整に伴い、22年3Q（7-9月期）の売上高はQoQ -9%
- ・22年4Q（10-12月期）のガイダンスでは、売上高はQoQ -20%

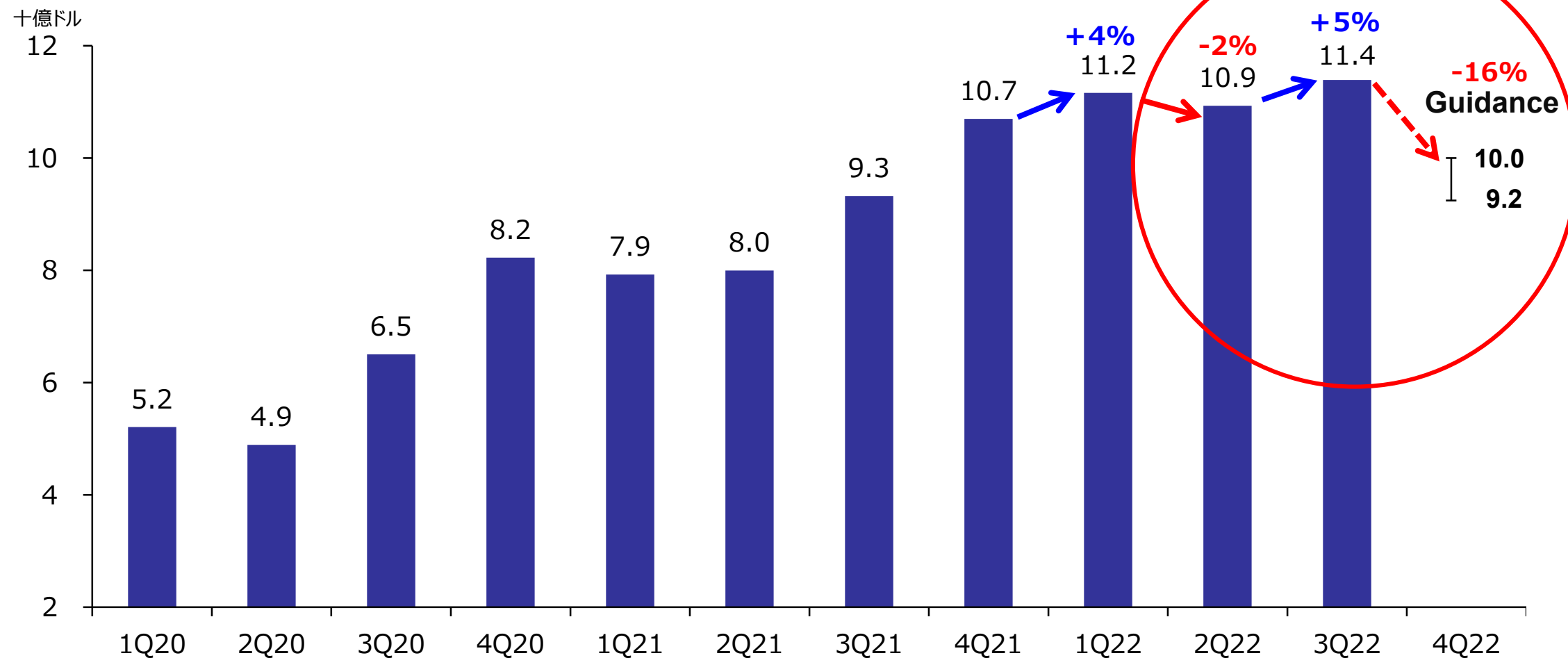


《暦年ベース》

クアルコム 売上高 (2022年4-6月期)

出所：クアルコム公開情報よりフジミ作成

- 22年3Q (7-9月期) の売上高はQoQ+5%
- 22年4Q (10-12月期) のガイダンスでは、売上高はQoQ -16%



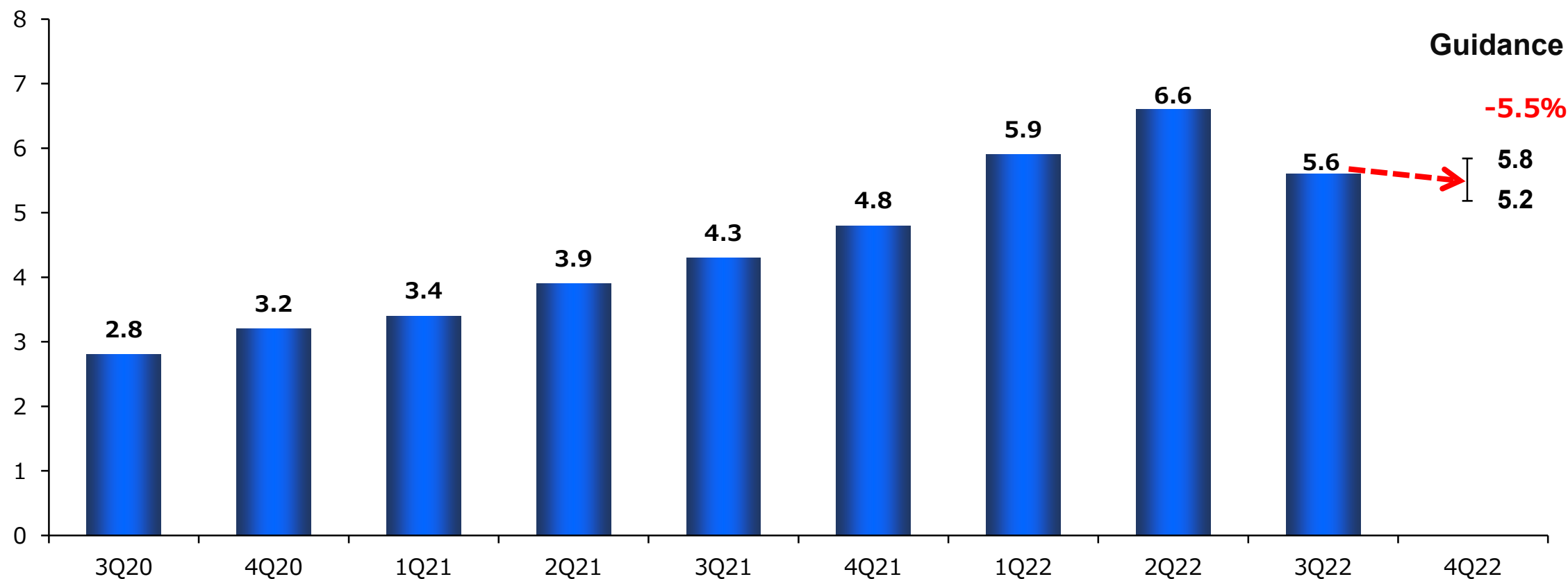
《暦年ベース》

AMD 売上高（2022年7-9月期）

出所：AMD公開情報よりフジミ作成

- 22年3Q（7-9月期）の売上高はQoQ -16%
- 22年4Q（10-12月期）のガイダンスでは、売上高はQoQ -5.5%
- 減収の主な要因は、PC市場の落ち込みによる需要軟化
- サプライチェーン上にも在庫が積み上がっている

US \$ Billion



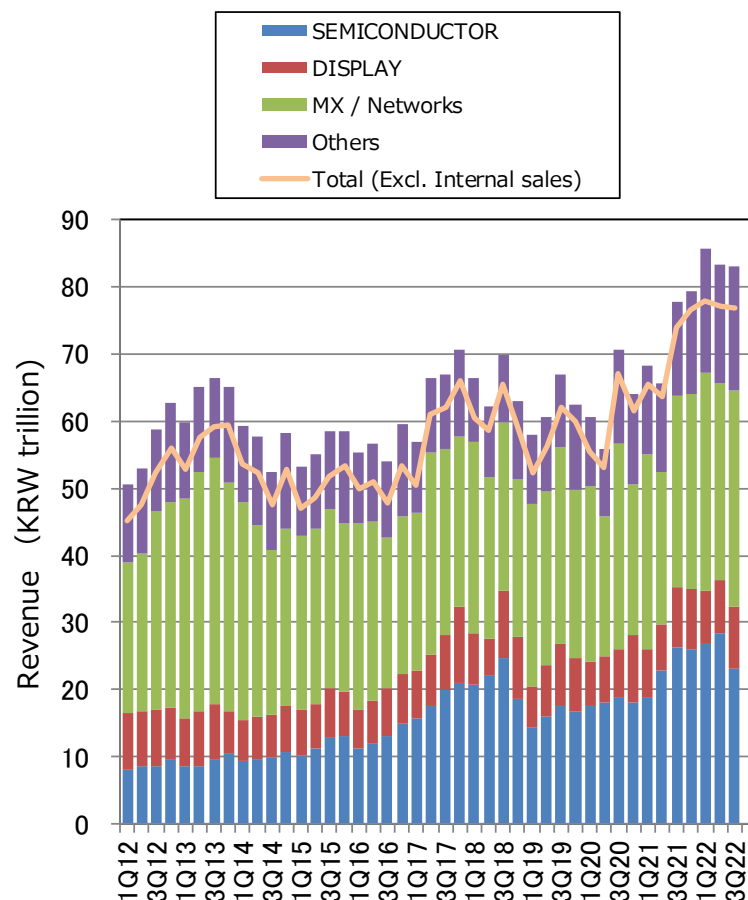
《暦年ベース》

サムスン電子 売上高（2022年7-9月期）

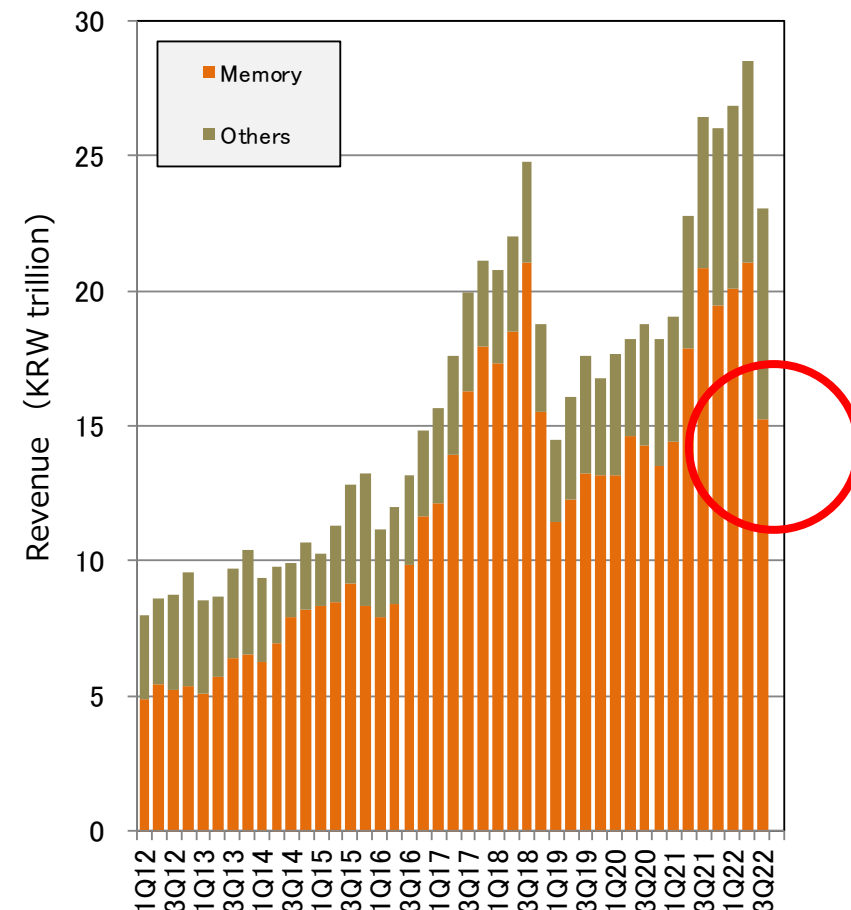
出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

- 半導体事業は、メモリの減速により、22年3Q（7-9月期）売上高はQoQ -19%

＜サムスン電子 全社 売上高＞



＜サムスン電子 半導体事業 売上高＞

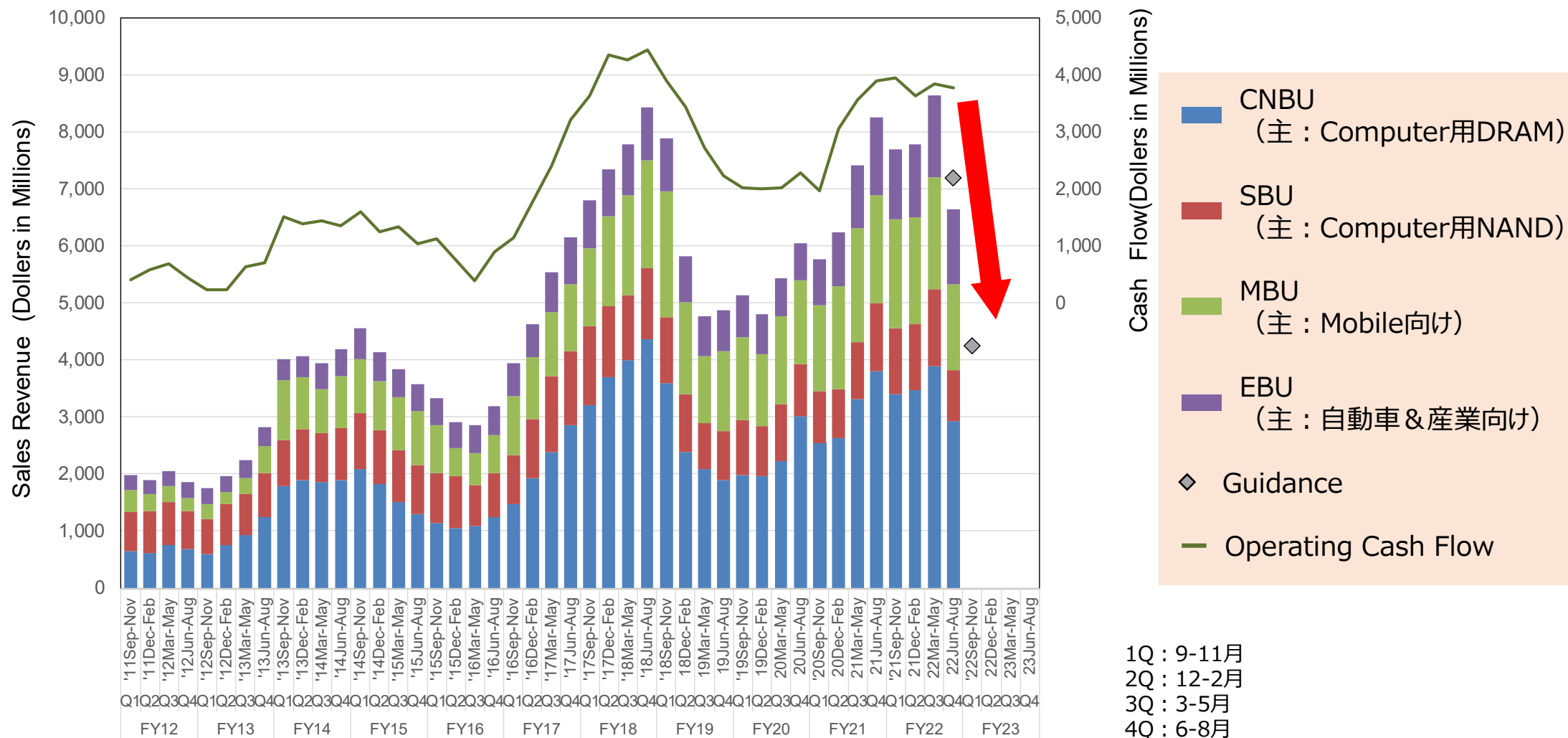


《暦年ベース》

マイクロン・テクノロジー 売上高（2022年7-9月期）

出所：マイクロン・テクノロジー公開情報よりフジミ作成

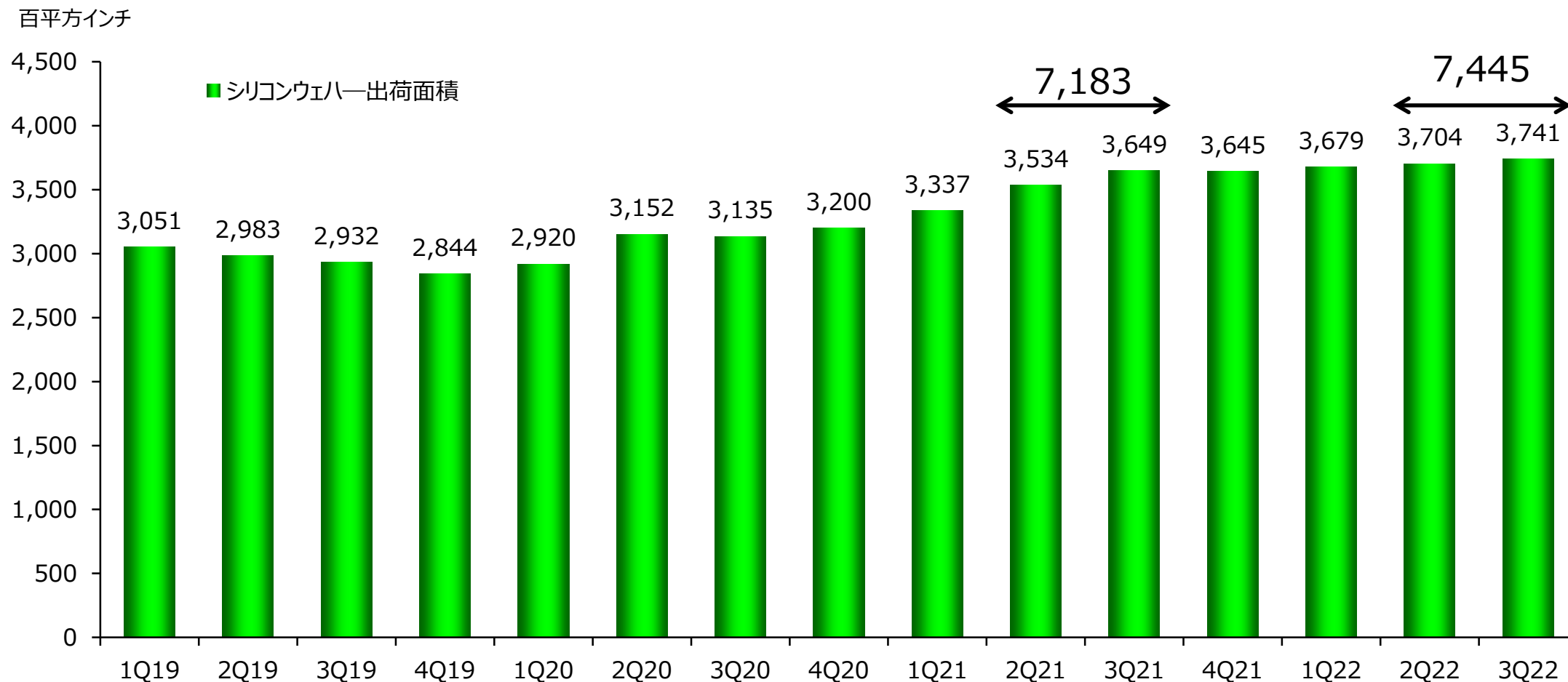
- 22年6-8月期 売上高はQoQ -23%
- 22年9-11月期のガイダンスでは、売上高はQoQ -34%



シリコンウェハー出荷面積 実績（四半期）

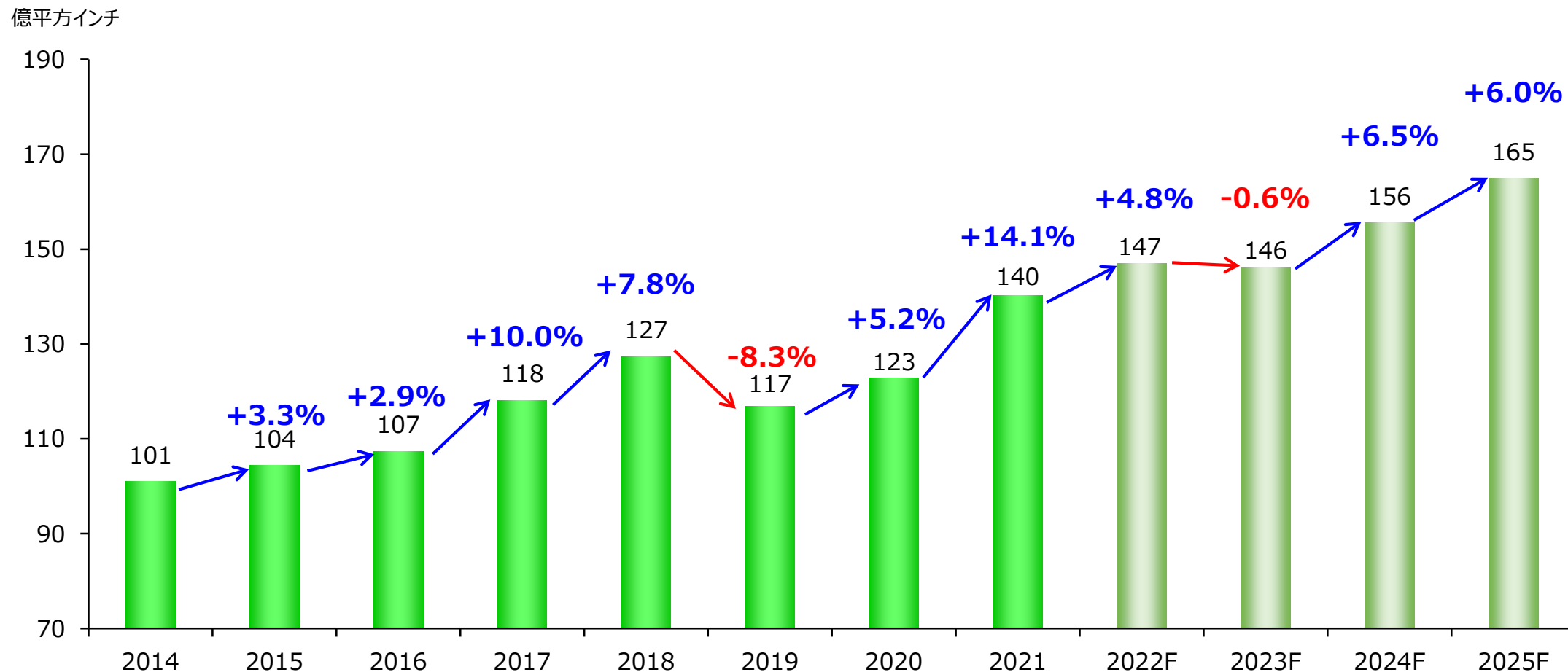
出所：SEMI（2022/10/27）

- 2022年4-9月期のシリコンウェハー出荷面積は前年同期比+3.6%



《暦年ベース》

- 2022年は+4.8%を見込むも、2023年はマイナス成長予測

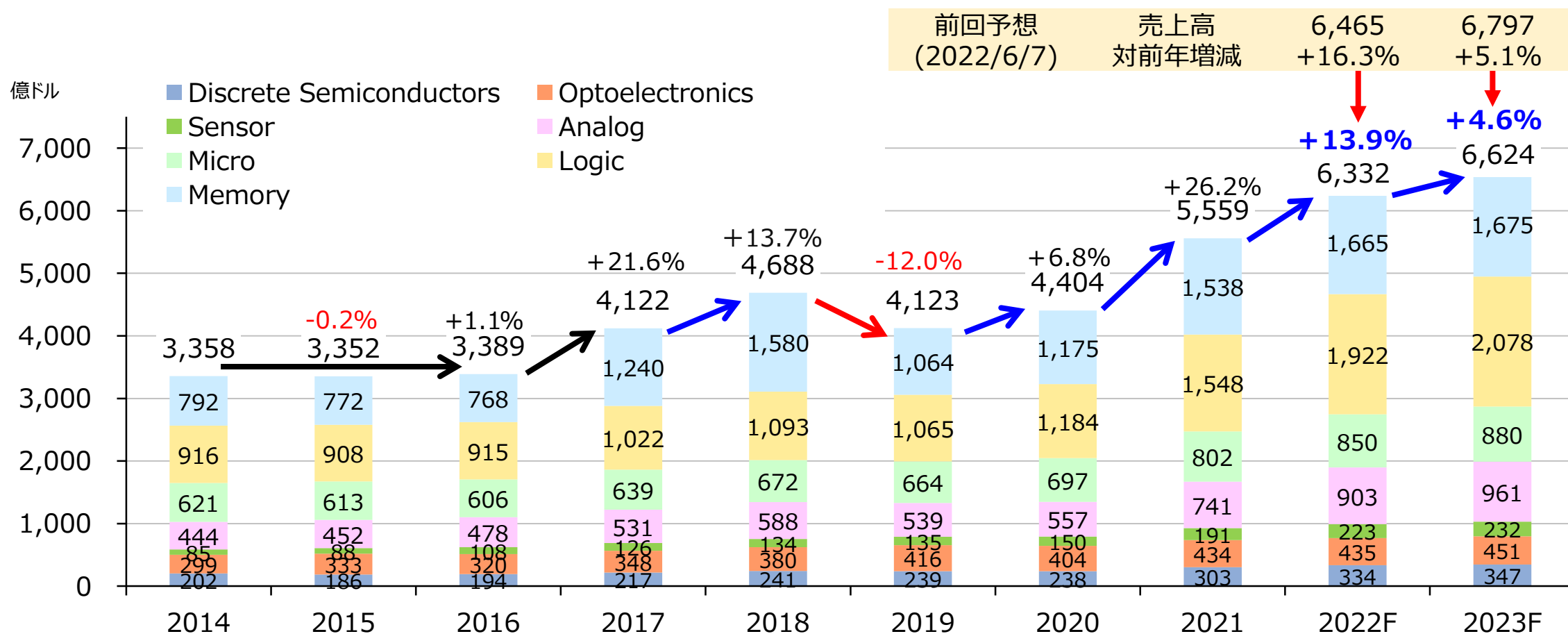


世界半導体市場動向（年次 WSTS予測） 用途別

出所：WSTS（2022/8/22）

- 2022年、2023年の市場予想は、世界的な景気後退の懸念により、8月に下方修正
- 2022年の市場予想は、メモリ市場の軟化により、16.3%（前回6月予想）から13.9%へ下方修正
- 2023年の市場予想は、5.1%から4.6%へ下方修正

（ただし、足元の状況を鑑みると、2023年の市場は、かなり厳しくなるものと予想される）



《暦年ベース》

決算概要

決算概要（上期実績）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('22/5)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/5)
売上高	25,291	26,439	28,500	31,097	+23.0%	+17.6%	+9.1%
営業利益 率	6,158 24.4%	5,900 22.3%	6,500 22.8%	7,819 25.1%	+27.0% -	+32.5% -	+20.3% -
経常利益 率	6,357 25.1%	6,133 23.2%	6,550 23.0%	8,293 26.7%	+30.5% -	+35.2% -	+26.6% -
四半期純利益 率	4,803 19.0%	4,353 16.5%	4,800 16.8%	6,155 19.8%	+28.1% -	+41.4% -	+28.2% -

・前年同期比 大幅増収増益

- ロジック、メモリともに最先端半導体需要好調・一部顧客の在庫積増し（サイバー攻撃後のリカバリー出荷を含む）
- シリコンウェハーも高稼働で推移
- このため、製品構成が良化
- 為替差益による経常利益増

・為替実績 133円／ドル

業績予想（下期予想）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/5)	下期 修正予想 ('22/11)	前年同期比	同年上期比	期初予想比 ('22/5)
売上高	25,291	26,439	31,097	29,500	31,103	+17.6%	+0.0%	+5.4%
営業利益 率	6,158 24.4%	5,900 22.3%	7,819 25.1%	7,000 23.7%	6,980 22.4%	+18.3% -	△10.7% -	△0.3% -
経常利益 率	6,357 25.1%	6,133 23.2%	8,293 26.7%	7,050 23.9%	7,006 22.5%	+14.2% -	△15.5% -	△0.6% -
四半期純利益 率	4,803 19.0%	4,353 16.5%	6,155 19.8%	5,200 17.6%	5,344 17.2%	+22.8% -	△13.2% -	+2.8% -

- ・前年同期比では大幅増収増益だが、上期比では売上高横ばいなるも減益
 - 売上高：円安による増収を見込むも、サイバー攻撃後のリカバリー出荷終了、半導体需要の軟化(CMP)、HDD低迷
 - 利益：円安による増益、製品の値上げを見込むも、原材料価格高騰や経費増加により減益
- ・想定為替レート：145円／ドル

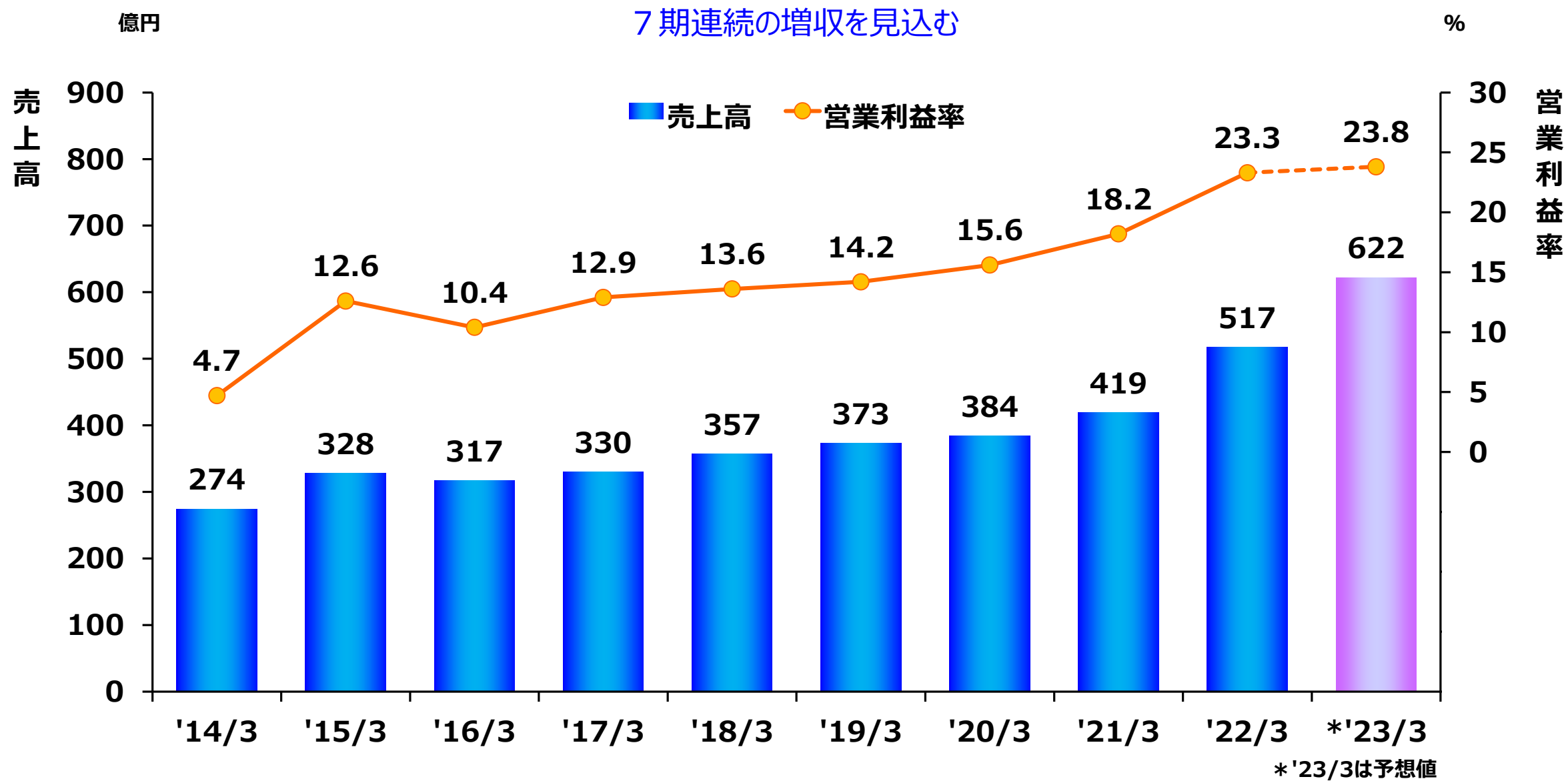
業績予想（通期予想）

単位：百万円

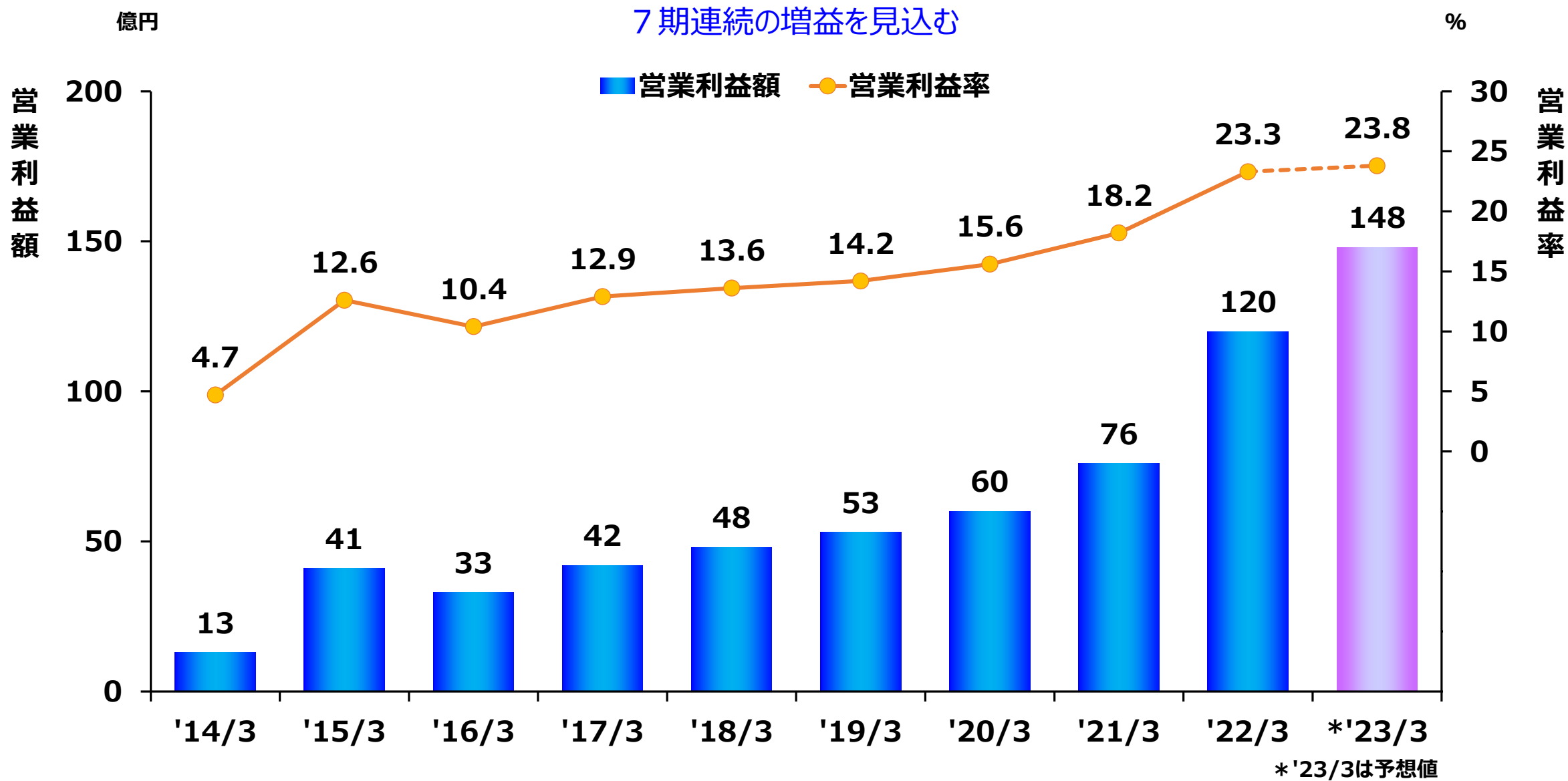
	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	期初予想 ('22/5)	修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/5)
売上高	51,731	58,000	62,200	+20.2%	+7.2%
営業利益 率	12,059 23.3%	13,500 23.3%	14,800 23.8%	+22.7% -	+9.6% -
経常利益 率	12,490 24.1%	13,600 23.4%	15,300 24.6%	+22.5% -	+12.5% -
当期純利益 率	9,156 17.7%	10,000 17.2%	11,500 18.5%	+25.6% -	+15.0% -

- ・増収増益予想（売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに、過去最高の更新を見込む）
- シリコン売上高：前期比+17.9%予想
 - CMP売上高：前期比+26.2%予想

業績推移（今期予想含む）



営業利益（今期予想含む）



用途別売上高

用途別売上高（上期実績）

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハ	ラッピング	2,985	3,264	3,550	3,538	+18.5%	+8.4%	△0.3%
	ポリシング	6,007	6,142	7,020	7,013	+16.7%	+14.2%	△0.1%
	切断	136	129	130	109	△19.5%	△15.4%	△15.5%
	計	9,129	9,536	10,700	10,661	+16.8%	+11.8%	△0.4%
CMP		12,155	12,416	13,400	15,771	+29.8%	+27.0%	+17.7%
ディスク	アルミディスク	770	913	965	987	+28.1%	+8.1%	+2.3%
	ガラスディスク	19	21	15	14	△25.0%	△30.0%	△0.2%
	計	790	935	980	1,002	+26.8%	+7.2%	+2.3%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,310	2,338	+9.2%	+3.1%	+1.2%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,050	1,252	+29.3%	+2.3%	+19.3%
	計	3,109	3,491	3,360	3,590	+15.5%	+2.8%	+6.9%
製品売上高		25,185	26,379	28,440	31,026	+23.2%	+17.6%	+9.1%
商品売上高		106	60	60	70	△33.8%	+17.0%	+1.0%
売上高 合計		25,291	26,439	28,500	31,097	+23.0%	+17.6%	+9.1%

用途別売上高（通期予想）

単位：百万円

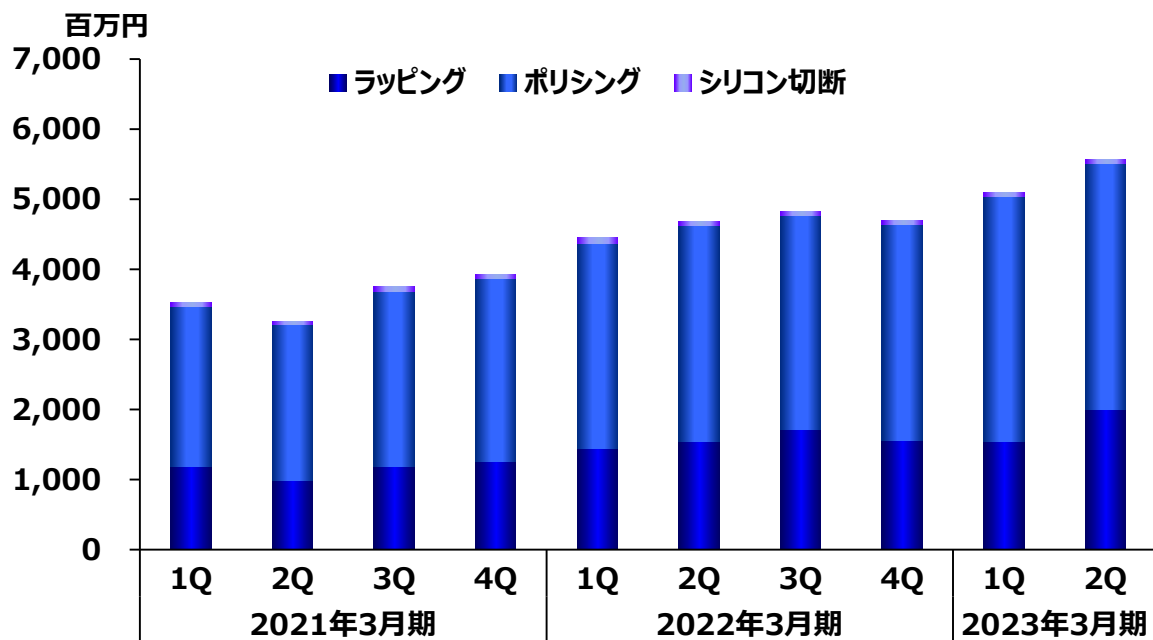
		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期 修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハ	ラッピング	4,604	6,249	7,190	7,421	+18.7%	+3.2%
	ポリシング	9,621	12,149	14,100	14,144	+16.4%	+0.3%
	切断	245	266	260	233	△12.5%	△10.4%
	計	14,472	18,665	21,550	21,800	+16.8%	+1.2%
CMP		20,037	24,571	27,400	31,000	+26.2%	+13.1%
ディスク	アルミディスク	1,668	1,684	1,945	1,650	△2.1%	△15.2%
	ガラスディスク	36	41	55	50	+20.9%	△9.1%
	計	1,705	1,725	2,000	1,700	△1.5%	△15.0%
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,779	4,408	4,730	5,000	+13.4%	+5.7%
	一般工業用(非研磨材)	1,909	2,192	2,200	2,600	+18.6%	+18.2%
	計	5,688	6,600	6,930	7,600	+15.1%	+9.7%
製品売上高		41,903	51,564	57,880	62,100	+20.4%	+7.3%
商品売上高		52	167	120	100	△40.2%	△16.7%
売上高 合計		41,956	51,731	58,000	62,200	+20.2%	+7.2%

シリコンウェハー売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハー	ラッピング	2,985	3,264	3,550	3,538	+18.5%	+8.4%	△0.3%
	ポリシング	6,007	6,142	7,020	7,013	+16.7%	+14.2%	△0.1%
	切断	136	129	130	109	△19.5%	△15.4%	△15.5%
	計	9,129	9,536	10,700	10,661	+16.8%	+11.8%	△0.4%



- ・ 事業環境
 - 半導体業界の高い稼働に支えられシリコンウェハー市場は堅調
 - シリコンウェハーの出荷面積も上期は過去最高を更新
- ・ ラッピング、ポリシング製品の増収要因
 - 上記要因による堅調な需要
 - 原材料価格高騰に伴う売価アップ（ラッピング製品）
 - 1・2 研におけるシェアアップ継続（ポリシング製品）

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

・シリコンウェハーの高稼働の継続、ラッピングの原材料価格高騰に伴う売価アップ

「下期」

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期 修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハー	ラッピング	2,985	3,264	3,538	3,640	3,883	+19.0%	+9.7%	+6.7%
	ポリシング	6,007	6,142	7,013	7,080	7,132	+16.1%	+1.7%	+0.7%
	切断	136	129	109	130	123	△5.3%	+11.9%	△5.4%
	計	9,129	9,536	10,661	10,850	11,140	+16.8%	+4.5%	+2.7%

「通期」

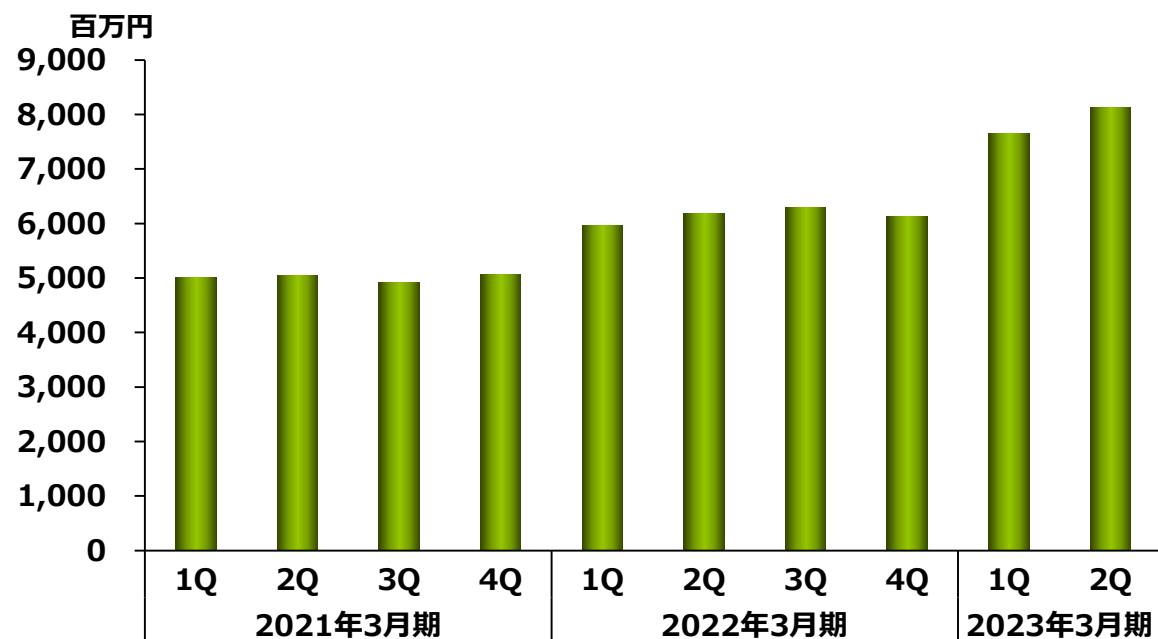
単位：百万円

		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期 修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
シリコンウェハー	ラッピング	4,604	6,249	7,190	7,421	+18.7%	+3.2%
	ポリシング	9,621	12,149	14,100	14,144	+16.4%	+0.3%
	切断	245	266	260	233	△12.5%	△10.4%
	計	14,472	18,665	21,550	21,800	+16.8%	+1.2%

《上期》

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
CMP	12,155	12,416	13,400	15,771	+29.8%	+27.0%	+17.7%



・事業環境

- PC及びスマートフォン市場の落ち込みに伴いロジック、メモリデバイスともに需要は軟化、在庫も増加
- 一方で、先端半導体デバイスでは高い稼働が継続

・CMP向け製品の増収要因

- ロジック、メモリともに最先端半導体需要好調
(一部顧客での在庫積み増し・サイバー攻撃後のリカバリー出荷もあり)
- 原材料価格高騰に伴う売価アップ
- 為替の影響

CMP売上高（下期予想・通期予想）

・ ロジック、メモリともに半導体需要の軟化を想定

「下期」

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期 修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
CMP	12,155	12,416	15,771	14,000	15,229	+22.7%	△3.4%	+8.8%

「通期」

単位：百万円

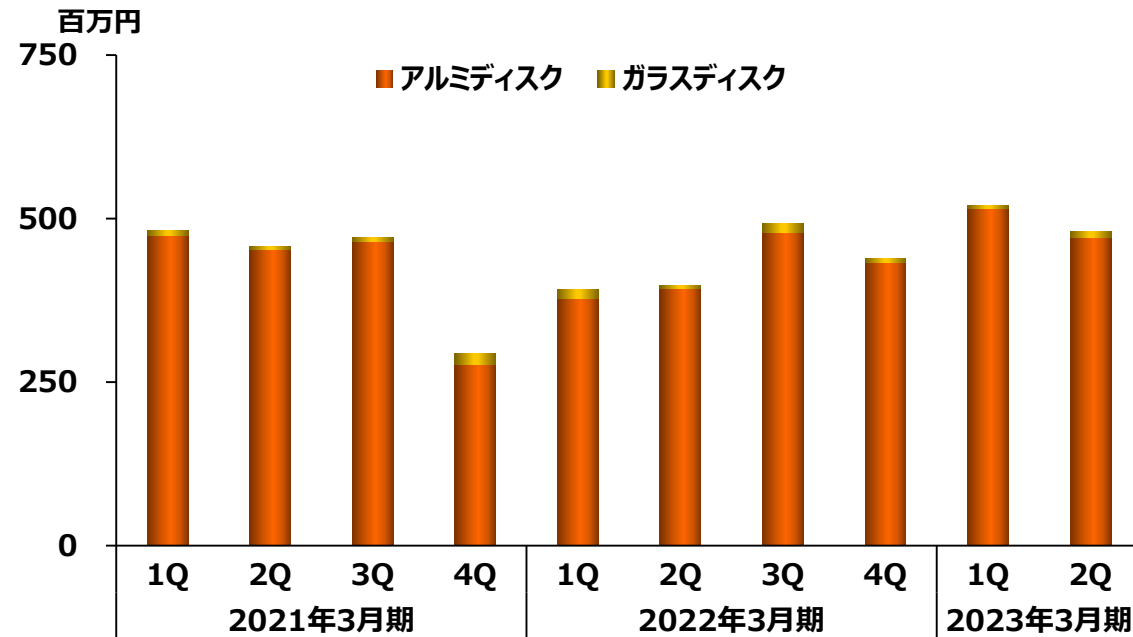
	21年3月期	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期 修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
CMP	20,037	24,571	27,400	31,000	+26.2%	+13.1%

ディスク売上高（上期実績）

≪上期≫

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
ディスク	アルミディスク	770	913	965	987	+28.1%	+8.1%	+2.3%
	ガラスディスク	19	21	15	14	△25.0%	△30.0%	△0.2%
	計	790	935	980	1,002	+26.8%	+7.2%	+2.3%



- ・ 事業環境
HDDからSSDへの移行
- ・ アルミディスク向け製品の増収要因
 - 当社顧客の稼働回復
 - 為替の影響

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

・ HDD市況低迷による需要減を想定

「下期」

単位：百万円

		22年3月期		22年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期 修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
ディスク	アルミディスク	770	913	987	980	663	△27.4%	△32.9%	△32.3%
	ガラスディスク	19	21	14	40	35	+63.7%	+133.8%	△12.5%
	計	790	935	1,002	1,020	698	△25.4%	△30.4%	△31.6%

「通期」

単位：百万円

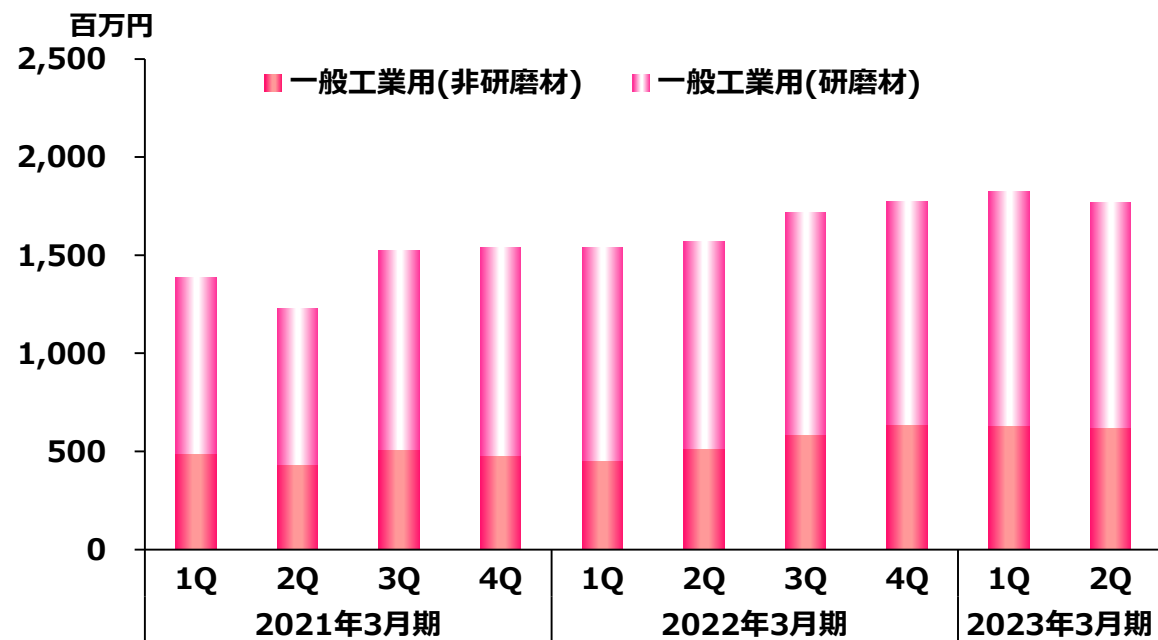
		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期 修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
ディスク	アルミディスク	1,668	1,684	1,945	1,650	△2.1%	△15.2%
	ガラスディスク	36	41	55	50	+20.9%	△9.1%
	計	1,705	1,725	2,000	1,700	△1.5%	△15.0%

機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		22年3月期		23年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 ('22/6)	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比 ('22/6)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,310	2,338	+9.2%	+3.1%	+1.2%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,050	1,252	+29.3%	+2.3%	+19.3%
	計	3,109	3,491	3,360	3,590	+15.5%	+2.8%	+6.9%



- ・ 上期の事業環境
 - 自動車及び産業機械向け需要の回復
 - 半導体製造装置の旺盛な投資
- ・ 一般工業用（研磨材）の増収要因
 - 上記要因により需要増加
- ・ 一般工業用（非研磨材）
 - 上記要因により需要増加

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

・ SiCウェハー向け研磨材の販売増を想定（マレーシア拠点で生産予定）

「下期」

単位：百万円

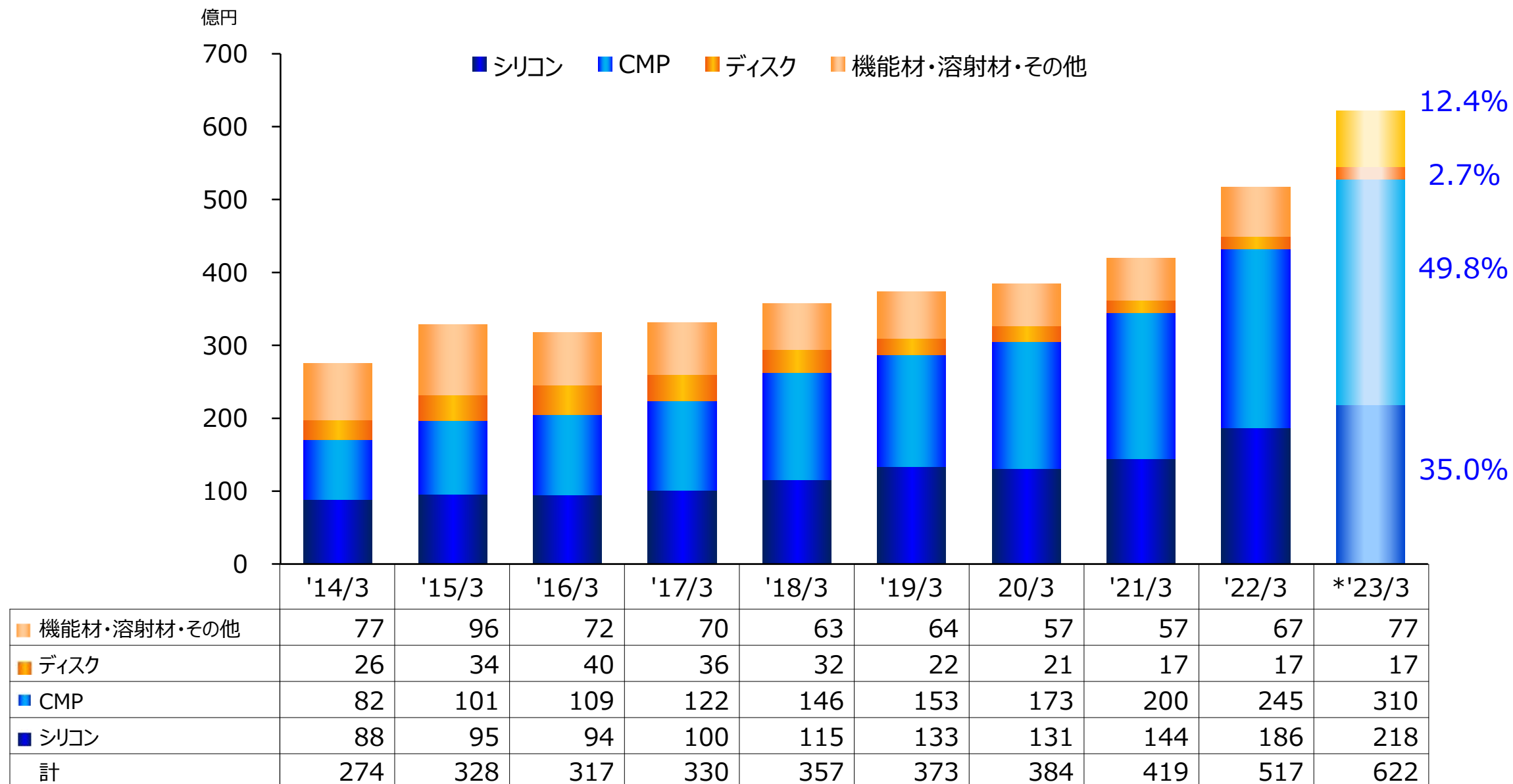
		22年3月期		23年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想 ('22/6)	下期 修正予想 ('22/11)	前年同期比	上期比	期初予想比 ('22/6)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	2,140	2,268	2,338	2,420	2,662	+17.4%	+13.8%	+10.0%
	一般工業用(非研磨材)	968	1,223	1,252	1,150	1,346	+10.0%	+7.5%	+17.0%
	計	3,109	3,491	3,590	3,570	4,008	+14.8%	+11.6%	+12.3%

「通期」

単位：百万円

		21年3月期	22年3月期	23年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想 ('22/6)	通期 修正予想 ('22/11)	前期比	期初予想比 ('22/6)
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,779	4,408	4,730	5,000	+13.4%	+5.7%
	一般工業用(非研磨材)	1,909	2,192	2,200	2,600	+18.6%	+18.2%
	計	5,688	6,600	6,930	7,600	+15.1%	+9.7%

用途別売上高（通期）



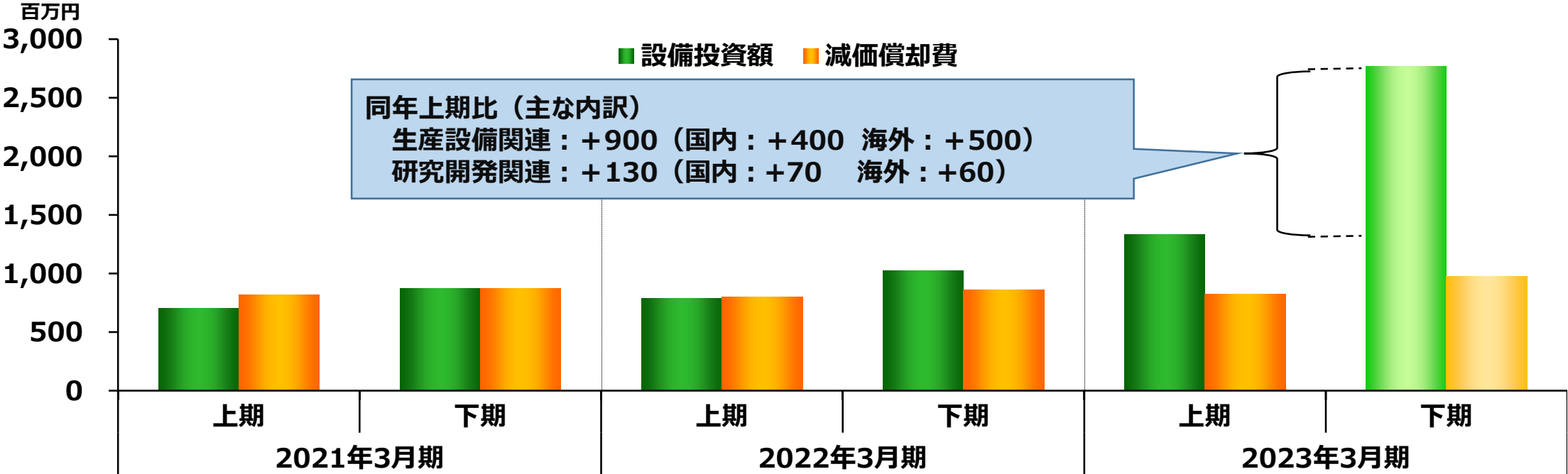
設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	22年3月期		23年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('22/6)	上期実績				下期計画 ('22/6)	下期 修正計画 ('22/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 ('22/6)
					前年同期比	前年下期比	計画比 ('22/6)					
設備投資額	789	1,024	1,800	1,333	+68.9%	+30.1%	△25.9%	1,600	2,766	+170.0%	+107.5%	+72.9%
減価償却費	802	859	850	826	+3.0%	△3.8%	△2.8%	950	973	+13.3%	+17.8%	+2.5%

* 設備投資額は検収基準



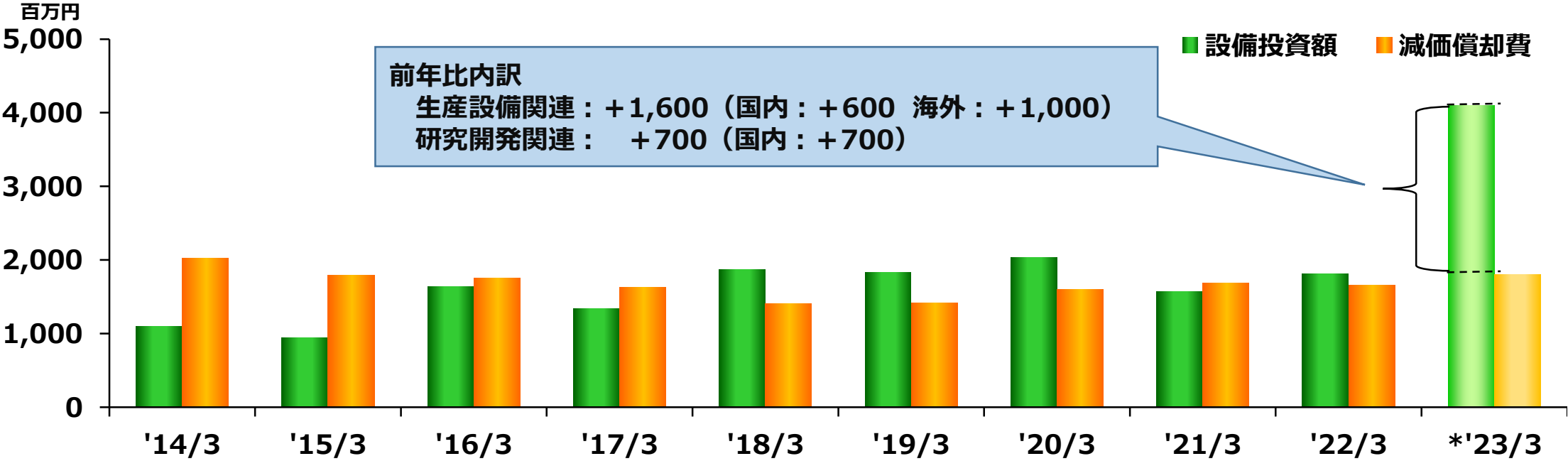
* '23/3下期は計画

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	通期計画 ('22/6)	通期 修正計画 ('22/11)	前期比	期初計画比 ('22/6)
設備投資	1,814	3,400	4,100	+126.0%	+20.6%
減価償却費	1,661	1,800	1,800	+8.3%	0.0%

* 設備投資額は検収基準

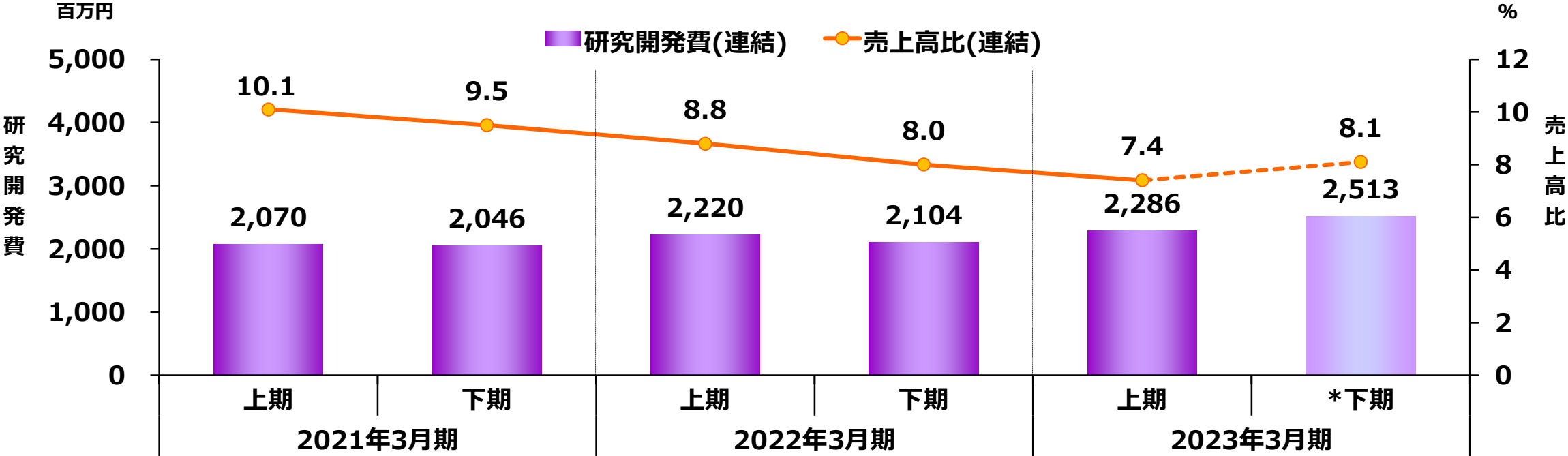


* '23/3は計画

研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

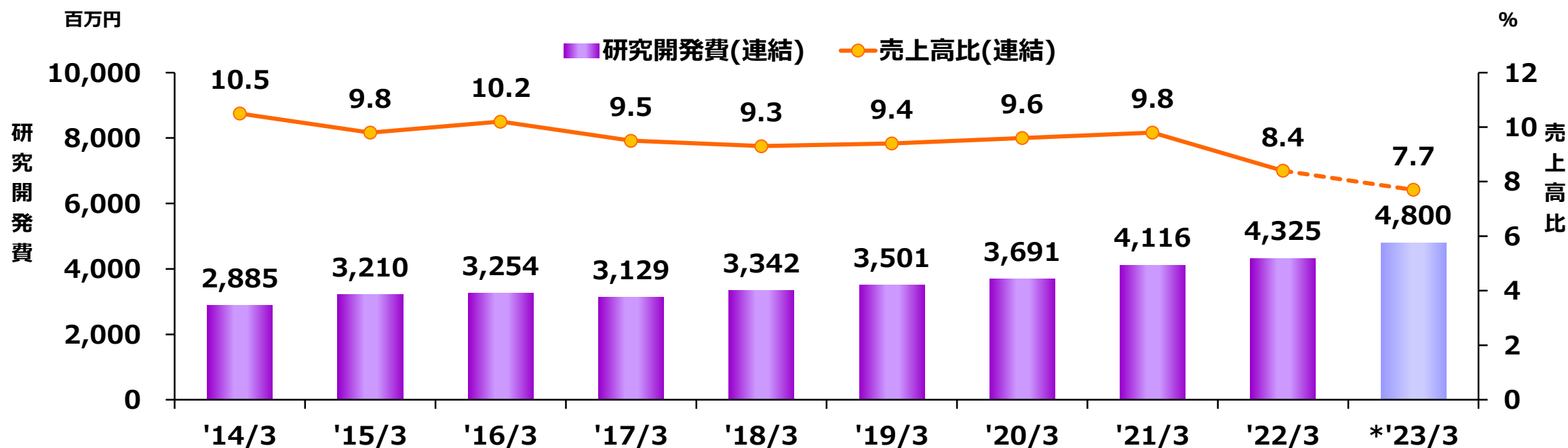
	22年3月期		23年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画 ('22/6)	上期実績				下期計画 ('22/6)	下期 修正計画 ('22/11)			
				上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比 ('22/6)		下期 修正計画 ('22/11)	前年同期比	同年上期比	計画比 ('22/6)
研究開発費	2,220	2,104	2,400	2,286	+3.0%	+8.7%	△4.7%	2,400	2,513	+19.4%	+9.9%	+4.7%



研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	22年3月期	23年3月期			
	通期実績	通期計画 ('22/6)	通期 修正計画 ('22/11)	前期比	期初計画比 ('22/6)
研究開発費	4,325	4,800	4,800	+11.0%	0.0%



損益分析

営業利益増減要因 22/3期上期実績 → 23/3期上期実績

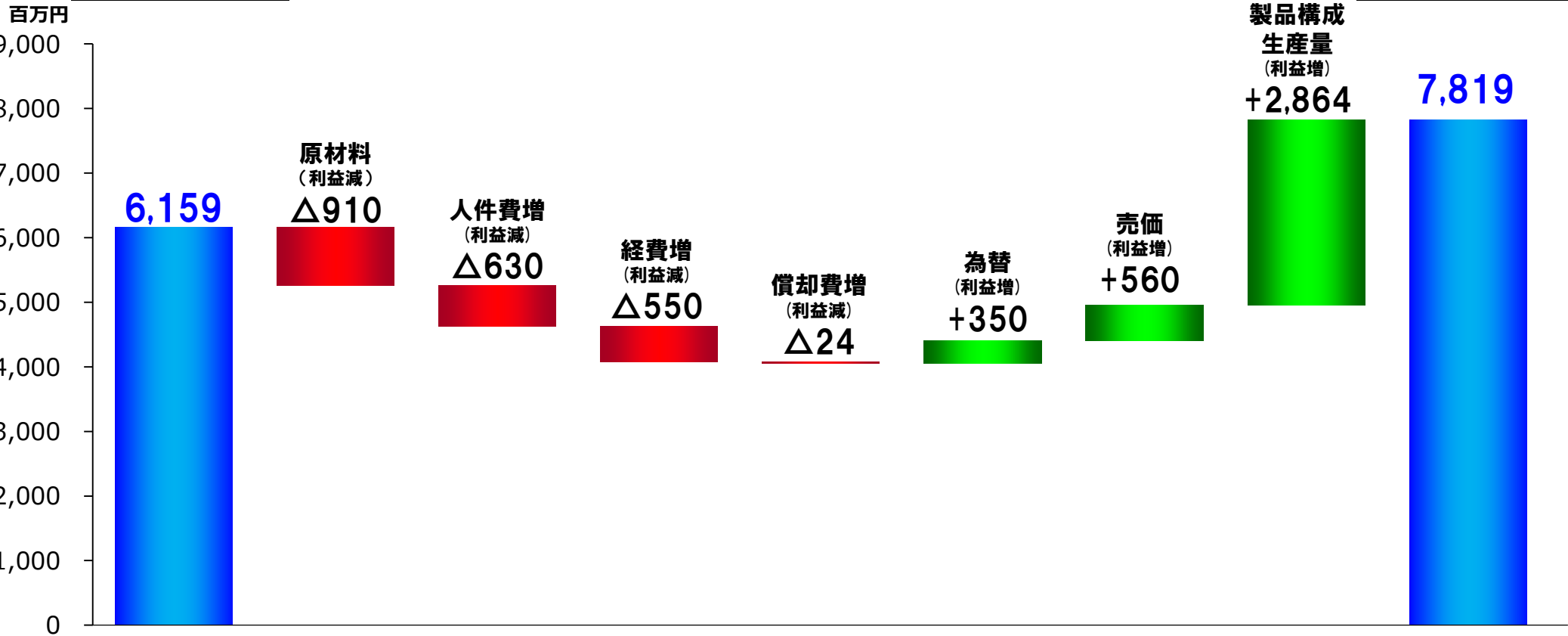
売上高 253億円

311億円

22/3期
上期実績

(売上増) +5,809百万円
(利益増) +1,660百万円

23/3期
上期実績



営業利益増減要因 23/3期上期実績 → 23/3期下期予想

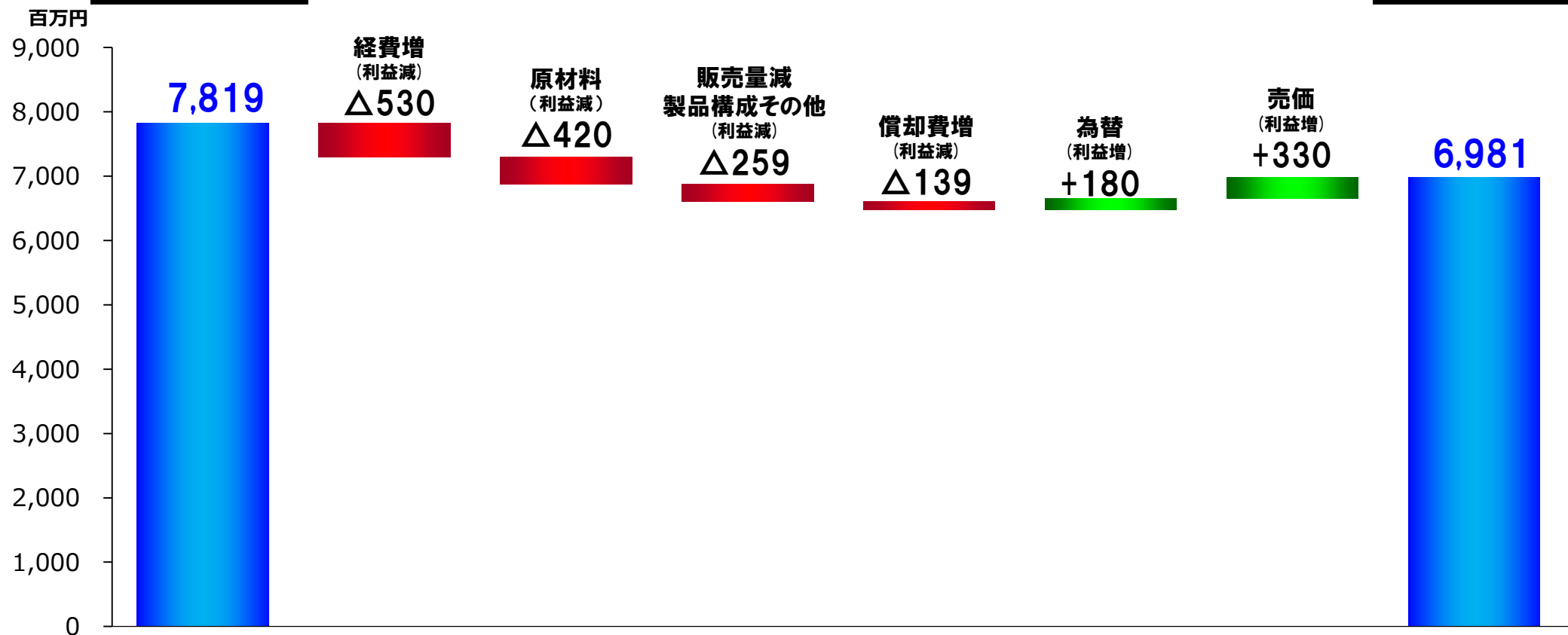
売上高 311億円

311億円

23/3期
上期実績

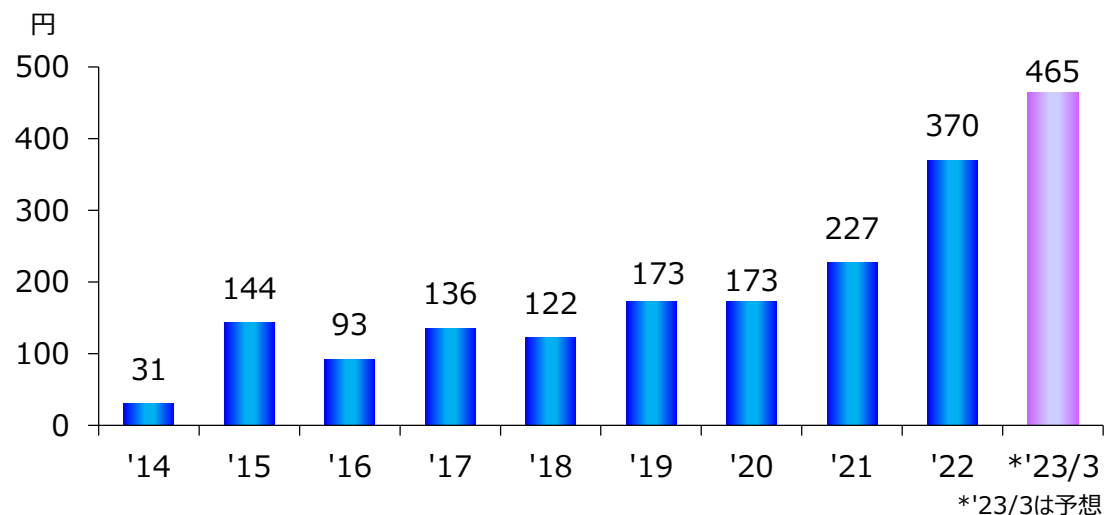
(売上増) +6百万円
(利益減) △838百万円

23/3期
下期予想

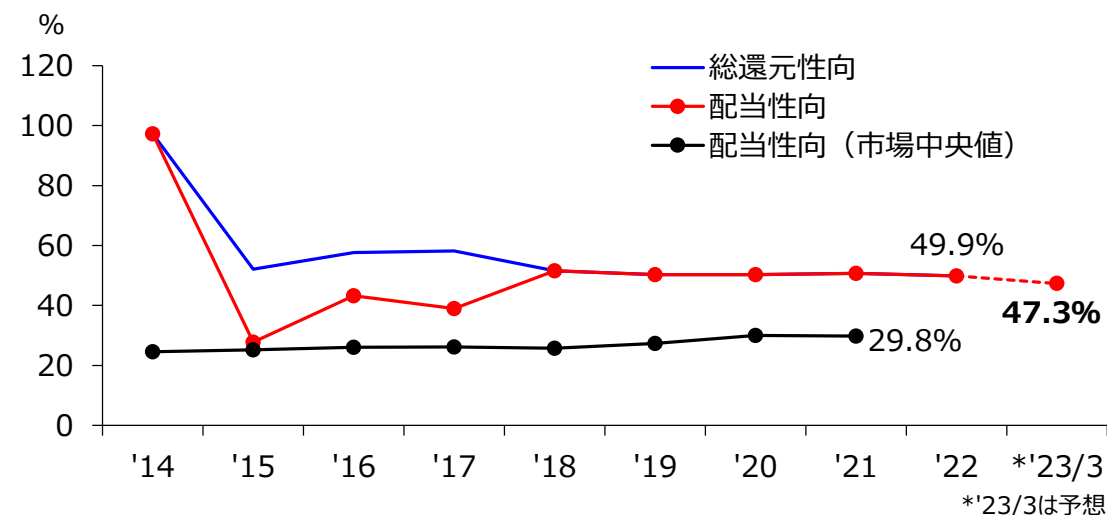


株主還元

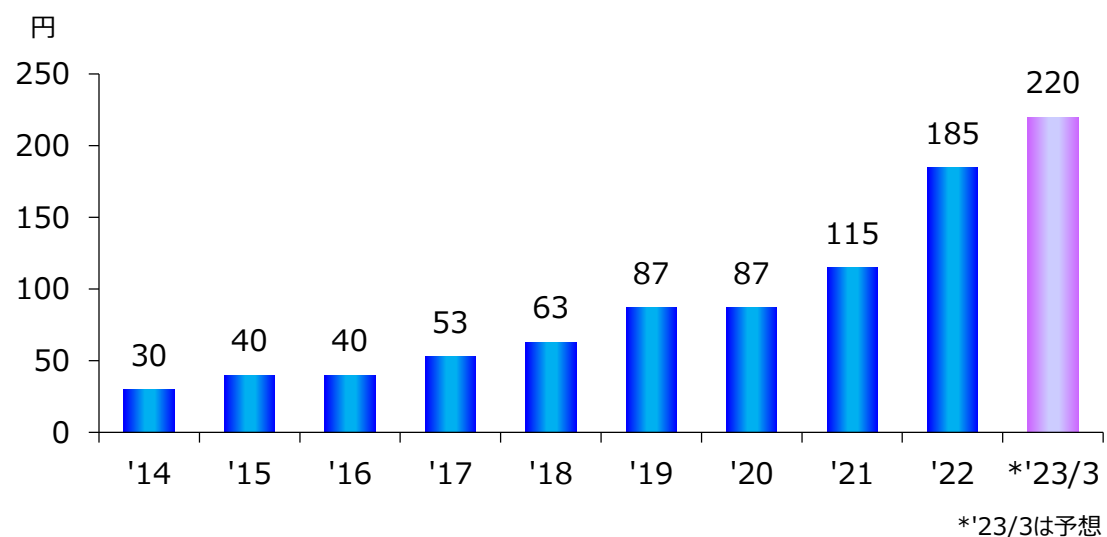
1株当たり当期純利益



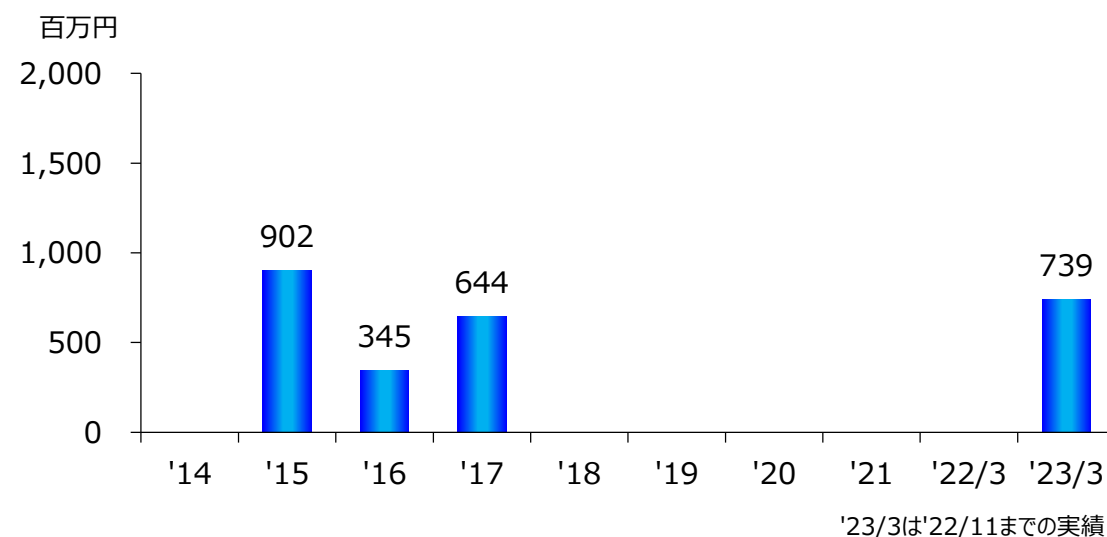
総還元性向・配当性向



1株当たり配当金



自己株買い



【2023年3月期 上期業績】 *前年同期比

✓ 売上高	+23.0%*	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品・シリコンウェハー向け製品の販売が好調 上期過去最高を更新
✓ 営業利益	+27.0%	: 最先端半導体関連製品の売上増加に加え、製品構成が良化
✓ 経常利益	+30.5%	: 為替円安
✓ 四半期純利益	+28.1%	: 営業利益、経常利益、四半期純利益ともに上期過去最高を更新
✓ シリコンウェハー向け	+16.8%	: 半導体業界の高稼働によりラッピング・ポリシングは増収
✓ CMP向け	+29.8%	: 半導体需要は軟化し在庫が増加するも、ロジック・メモリともに先端向け製品の販売増加
✓ ハードディスク向け	+26.8%	: HDDからSSDへの移行が進むもサーバー向けHDDの需要増加に加え為替の影響もあり増収
✓ 一般工業用向け	+9.2%	: 自動車及び産業機械向け需要の回復もあり増収
✓ 株主還元		: 業績の上振れに伴い、1株当たり配当額を期初予想95円から110円に増配（前年同期85円）

【2023年3月期 通期業績予想】 *前年比

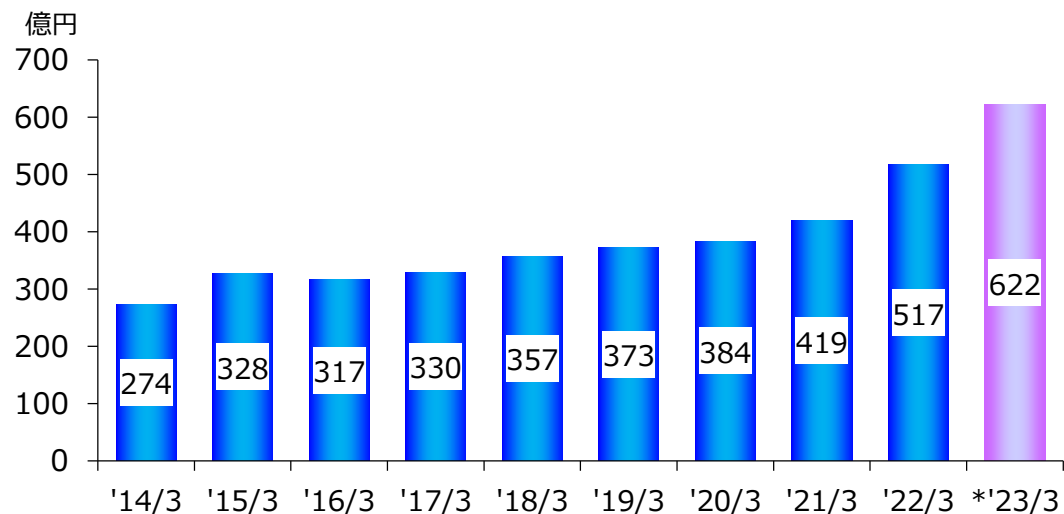
✓ 売上高	+20.2%	: 売上高は2期連続となる過去最高を見込む
✓ 営業利益	+22.7%	: 営業利益・経常利益ともに4期連続となる過去最高を見込む
✓ 経常利益	+22.5%	: 為替円安
✓ 当期純利益	+25.6%	: 当期純利益は5期連続となる過去最高を見込む

補足資料

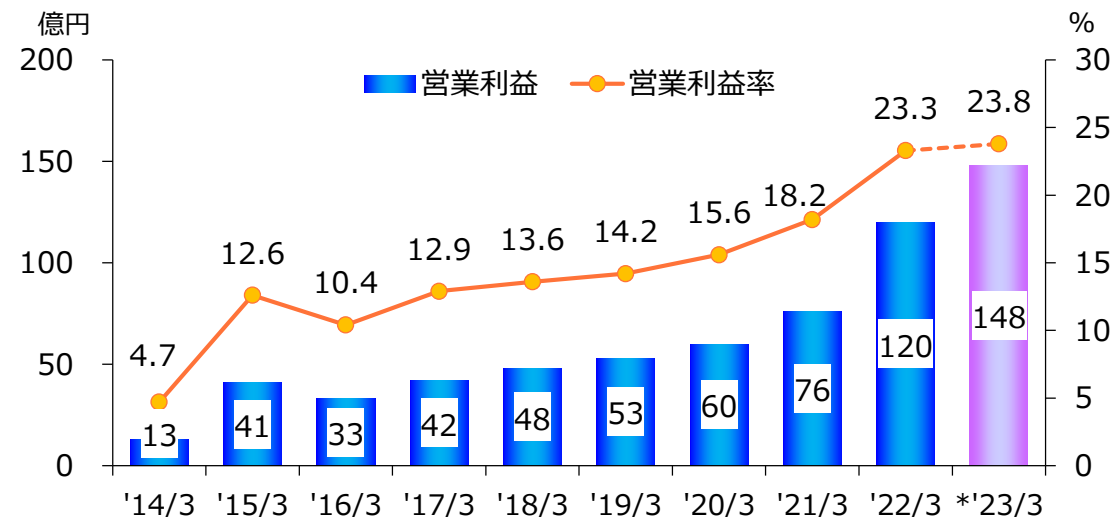
(人数)	22年3月期 (3月31日現在)		23年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時 雇用者 *	正社員	臨時 雇用者 *	前期末増減	
					正社員	臨時 雇用者
フジインコーポレーテッド	693	216	720	205	+27	△11
フジミコーポレーション	118	3	129	2	+11	△1
フジミ台湾	95	2	94	2	△1	—
フジミマイクロテクノロジー	67	5	67	5	—	—
フジミヨーロッパ	4	2	4	2	—	—
フジミ韓国	0	0	0	0	—	—
フジミ深圳	3	1	2	1	△1	—
合 計	980	229	1,016	217	+36	△12

・* 臨時雇用者（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

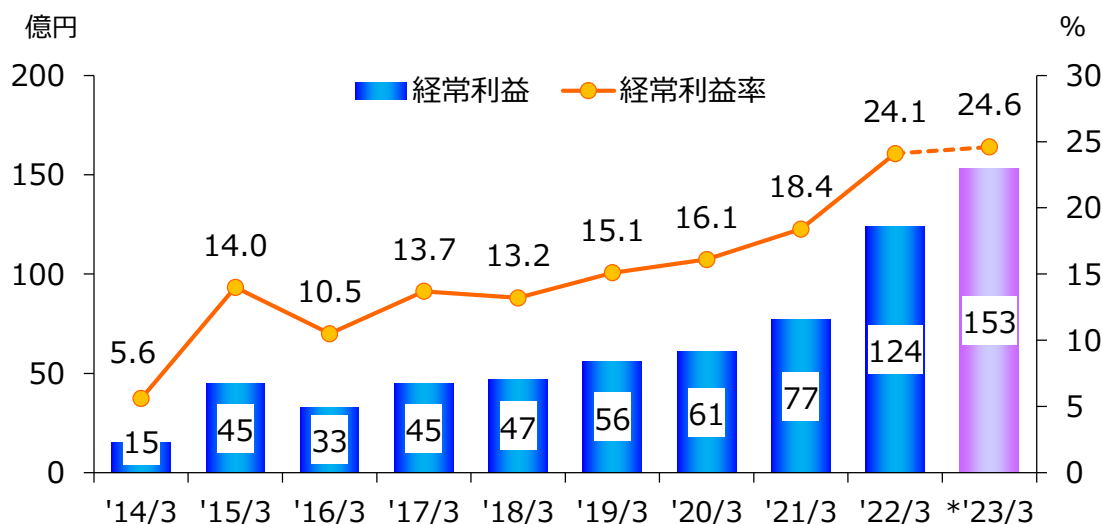
売上高



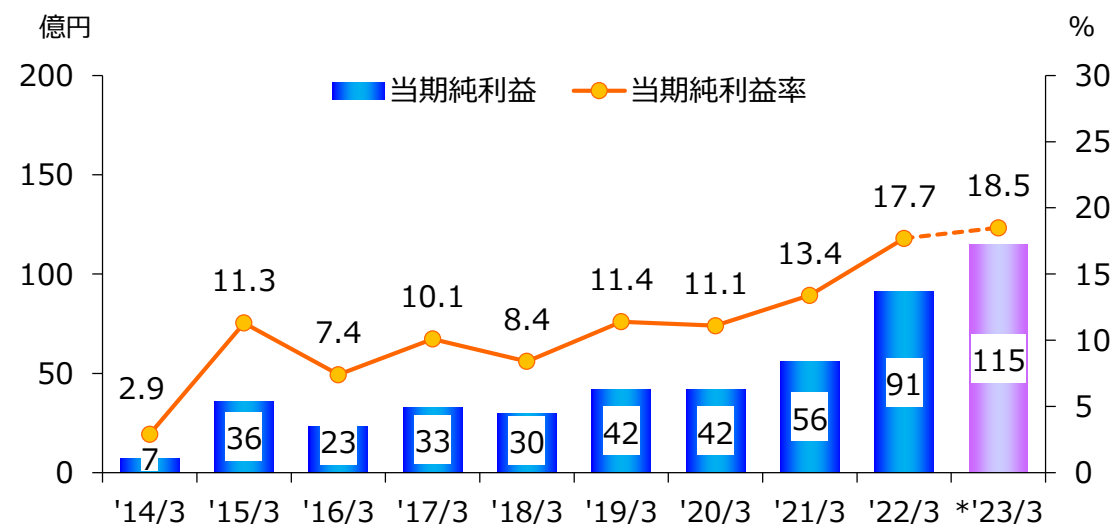
営業利益



経常利益



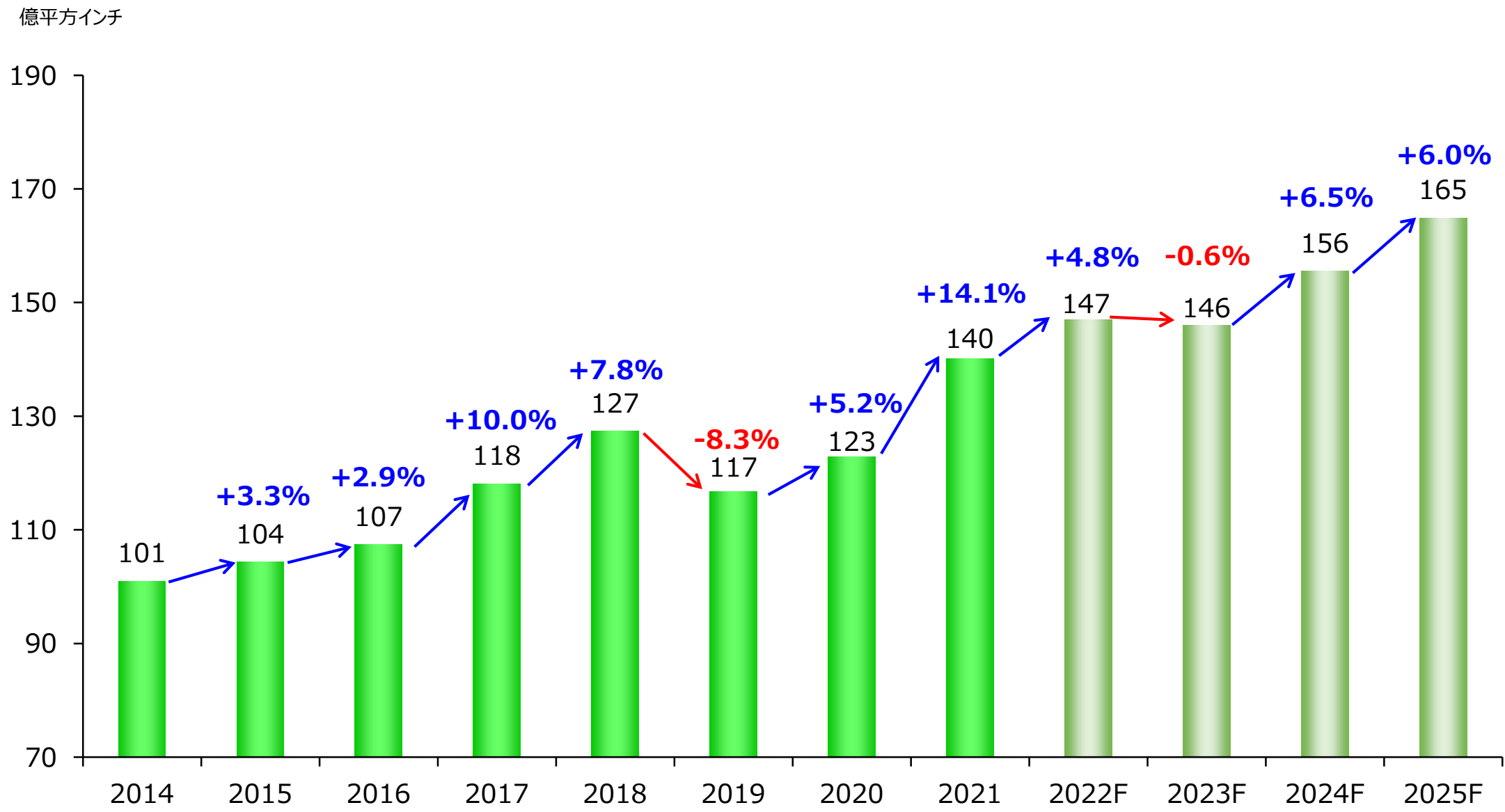
当期純利益



*'23/3は予想値

シリコンウェハー需要予測（出荷面積換算 全口径）

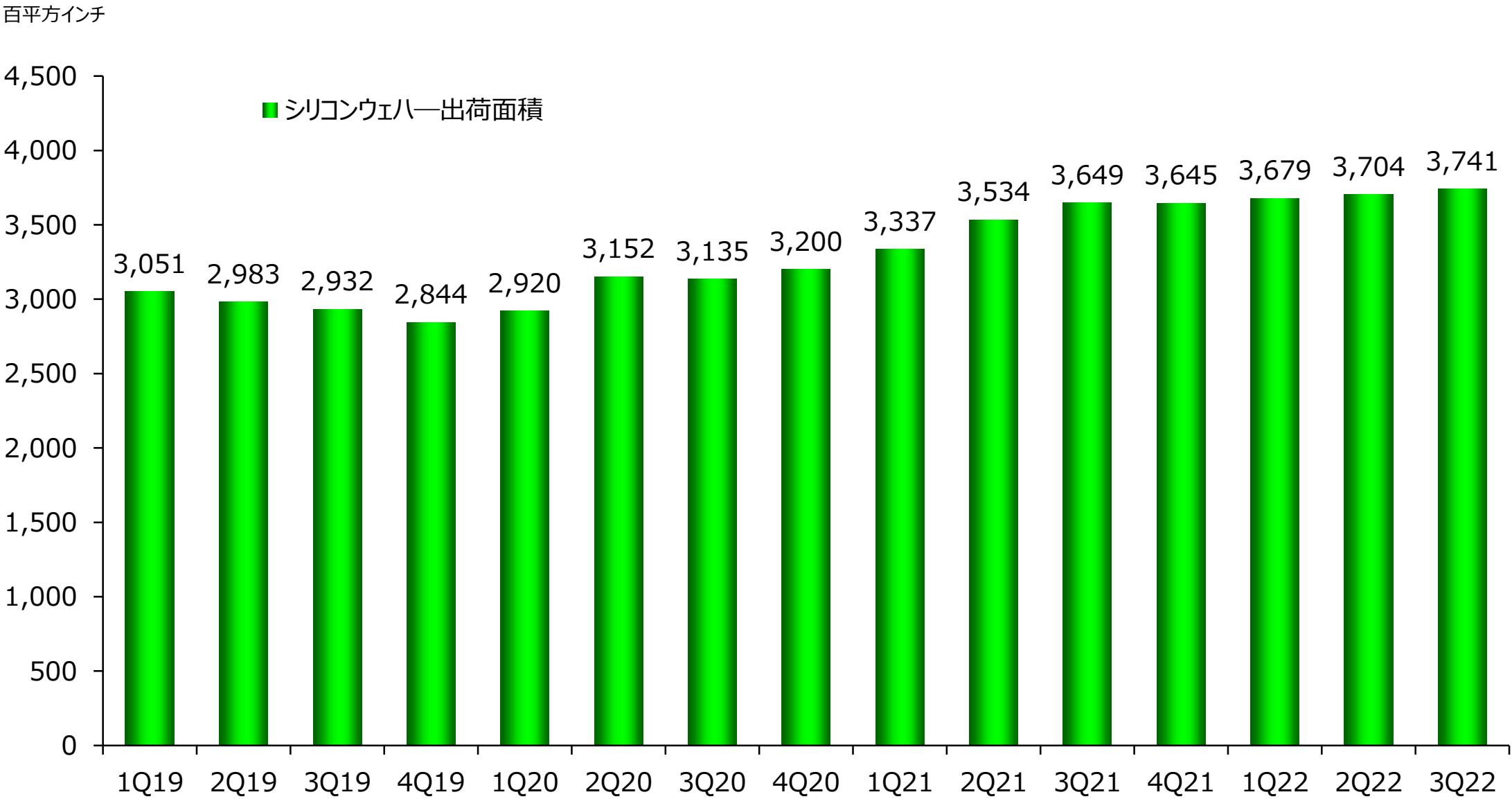
出所：SEMI（実績 2022/2/22 予測 2022/11/9）



《暦年ベース》

シリコンウェハー出荷面積（四半期）

出所： SEMI (2022/10/27)



《暦年ベース》

